



CORPORATE REPORT 2022

TOWA株式会社

〒601-8105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地

<https://www.towajapan.co.jp>

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。



Philosophy

経営理念

産業社会が最も求める「技術開発」を根幹に、
クォーター・リードに徹した
「新製品・新商品」の創成に向けて、
果敢なる挑戦のもと、全力を傾注して成果を生み出し、
もって産業の発展に多大の貢献をはたす。

Management Policy

経営の基本方針

TOWAグループは、超精密金型を創り出してきた「金型関連技術」が
当社のコア・コンピタンスであると考えております。
この原点に立ち戻って、コア・コンピタンスを活かした事業領域に
経営資源を集中し、QCD（Quality品質・Cost原価・Delivery納期）の
最適化を図り、収益体質を確立してまいります。
また、「薄型化・微細化・多段化」をテーマに技術革新が続く
半導体パッケージ技術の未来を見据え、
市場ニーズを先取りするソリューション提案型の
開発・生産・販売戦略に取り組んでまいります。

CONTENTS

1 プロフィール

- 1 経営理念・経営の基本方針
- 3 目次・編集方針
- 5 TOWAグループの事業内容

01

7 トップメッセージ



02

11 経営の全体像

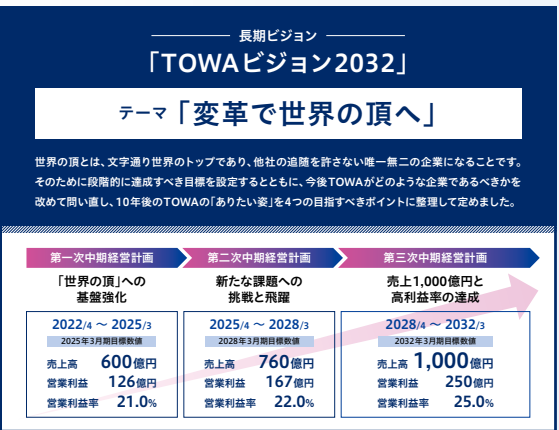
- 11 TOWAグループの歴史
- 13 TOWAグループの培った強み
- 15 TOWAグループの技術と製品
- 17 TOWAグループのビジネスモデル
- 19 財務・非財務ハイライト



03

21 価値創造の戦略

- 21 長期ビジョン「TOWAビジョン2032」
- 23 第一次中期経営計画(2022/4～2025/3)
- 27 特集1 戦略的技術
- 29 特集2 研究投資戦略
- 31 半導体事業
- 33 新事業
- 34 化成品事業
- 34 レーザ事業



04

35 価値創造の基盤

- 35 TOWAグループのサステナビリティ方針
- 37 TOWAグループの環境への取り組み
- 41 TOWAグループの社会への取り組み
- 45 TOWAグループのコーポレートガバナンス
- 49 役員一覧



51 財務情報・会社概要

- 51 財務情報
- 54 会社概要

編集方針

このたびTOWAグループのコーポレートレポートを発行しました。当社グループの経営上ミッションである「技術水準向上へのあくなき追求」を目指す戦略ストーリーについて、ステークホルダーの皆様に分かりやすくご理解いただけるよう編集いたしました。

まず、代表取締役社長岡田より、経営方針をお話したうえで、TOWAグループの根幹となる半導体製造装置事業を軸とした研究開発、事業展開と特徴、そしてESG方針を踏まえた今後の当社の方向性をご説明しております。

加えて、当社グループのESGの具体的取組みも掲載しています。TCFDに賛同し脱炭素を目指す取り組みをはじめとし、今後私たちが持つすべての資源を活用して社会課題の解決を目指す方針および体制についてご説明しております。

ステークホルダーの皆様との対話は、当社グループの持続的成長にとって必要不可欠であります。本報告書をご高覧頂き、忌憚のないご意見を賜れば幸いです。

報告対象期間

2021年度(2021年4月1日～2022年3月31日)を対象としていますが、それ以前、以後の情報も掲載しております。

報告対象範囲

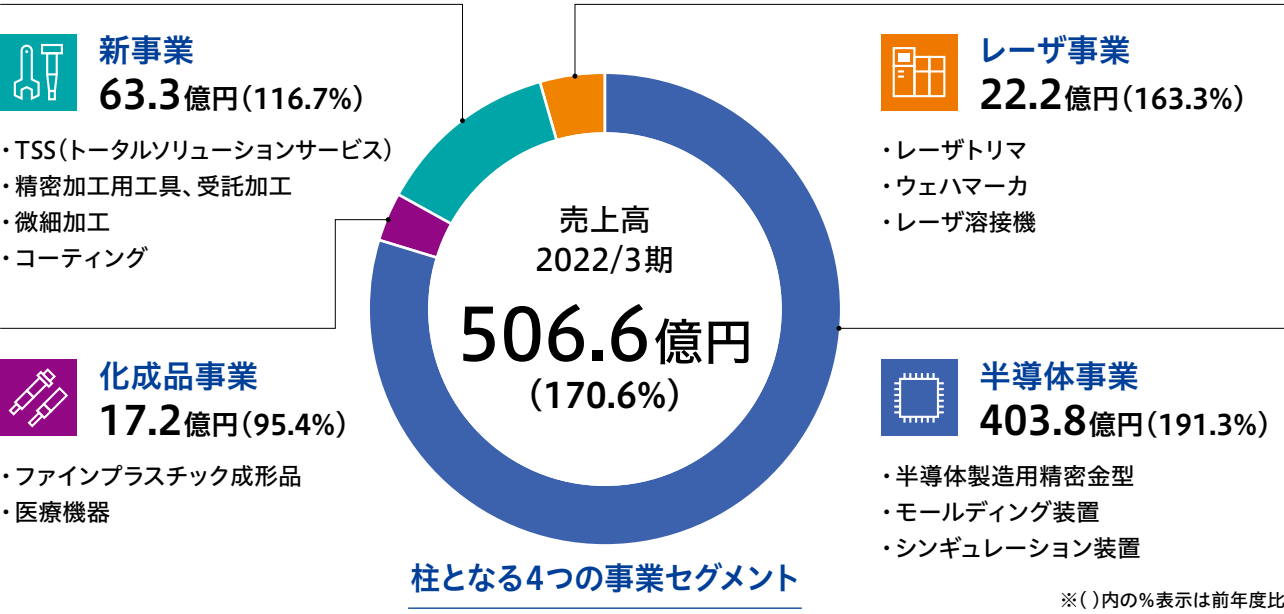
当社およびグループ会社

将来の見通しに関する注意事項

本報告書に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、作成時点で入手可能な情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、不確定な要素を含んでいます。実際の業績などはさまざまな要因により、見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知ください。

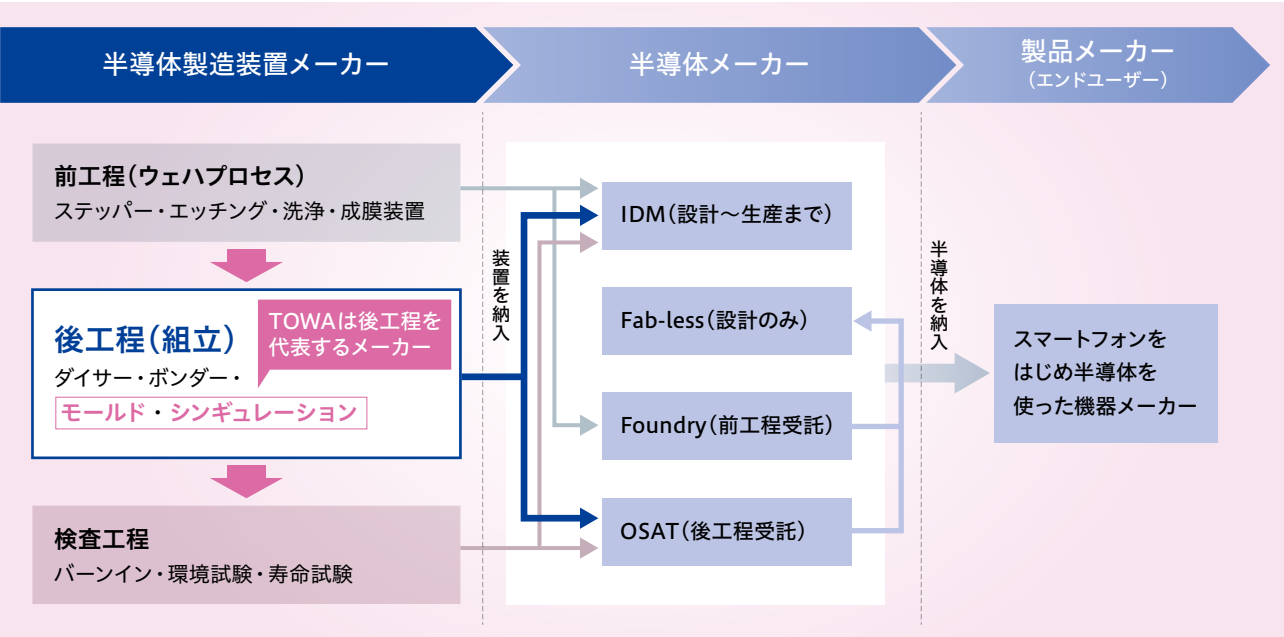
TOWAグループの事業内容

TOWAは技術開発型企業として43年来、ものづくりにおけるニーズを汲みとり、デファクトスタンダードを生み出してきました。現在、半導体事業を中心として、4つのセグメントを柱に、世界で事業を展開しています。



半導体製造におけるTOWAグループの立ち位置

半導体装置メーカーは、前工程・後工程・検査工程の各専用装置で住み分けされており、装置を半導体メーカーに納入します。半導体メーカーは装置メーカーの装置を使って半導体を製造し、半導体を使った製品をつくるメーカーに納入します。TOWAグループは後工程の半導体装置メーカーに属します。



各セグメント事業の紹介

	事業紹介	2021年収益・利益等実績											
半導体事業 当社グループの中心をなす事業です。半導体を保護する樹脂にて半導体を封止するモールド装置や金型、個片化のためのシンギュレーション装置を製造しています。 詳細はP.31 (百万円) <table><tr><td>2019</td><td>2020</td><td>2021 (年度)</td></tr><tr><td>17,070</td><td>21,110</td><td>40,384</td></tr></table>	2019	2020	2021 (年度)	17,070	21,110	40,384	化成品事業 金型製造で培った超精密微細加工技術を活かしてプラスチック製品の成形・組立を一貫して行っています。主に医療機器の製造が中心となっています。 詳細はP.34 (百万円) <table><tr><td>2019</td><td>2020</td><td>2021 (年度)</td></tr><tr><td>1,613</td><td>1,806</td><td>1,723</td></tr></table>	2019	2020	2021 (年度)	1,613	1,806	1,723
2019	2020	2021 (年度)											
17,070	21,110	40,384											
2019	2020	2021 (年度)											
1,613	1,806	1,723											
新事業 半導体製造装置で培ったコア技術をもとにした工具の販売、受託加工ビジネスや、部品供給、修理、改造、付加価値提案などトータルなサポートサービスを行っています。 詳細はP.33 (百万円) <table><tr><td>2019</td><td>2020</td><td>2021 (年度)</td></tr><tr><td>4,831</td><td>5,425</td><td>6,331</td></tr></table>	2019	2020	2021 (年度)	4,831	5,425	6,331	レーザ事業 抵抗値を調整するレーザトリミング装置やウェハに管理番号をマーキングするウェハマーキング装置等を製造しています。 詳細はP.34 (百万円) <table><tr><td>2019</td><td>2020</td><td>2021 (年度)</td></tr><tr><td>1,737</td><td>1,364</td><td>2,227</td></tr></table>	2019	2020	2021 (年度)	1,737	1,364	2,227
2019	2020	2021 (年度)											
4,831	5,425	6,331											
2019	2020	2021 (年度)											
1,737	1,364	2,227											

01 TOP MESSAGE



代表取締役社長
岡田 博和

さらなる成長と企業価値の向上を追求し、
世界において他社の追従を許さない
唯一無二の企業をめざしてまいります。

創業以来、三度にわたる「モールドイング革命」を通じて、半導体業界の発展に貢献

私ども TOWA は、半導体製造における後工程の装置をつくるメーカーです。その後工程の一つが、半導体チップを特殊な樹脂で保護するモールドイング工程であり、この完全自動装置を世界で初めて製品化したことをきっかけに、現在、世界シェアでトップの地位を占めています。加えて、樹脂で半導体チップを一括封止したのちに切断し個片化するシンギュレーション工程の製品も手がけており、オンリーワンの技術を強みとして、こちらも世界トップクラスの地位にあります。

当社の原点は、1979年、半導体産業の黎明期にあって、創

業者の坂東和彦が超精密金型および半導体製造装置の製造販売を始めたことにさかのぼります。創業当初から「モールドイング革命」を標榜し、時代ごとに技術革新を成し遂げたことで、お客様に数々の斬新な製造技術を提案してまいりました。

たとえば、「第一次モールドイング革命」では、創業期に完成させた「マルチプランジャ成形システム」は、半導体パッケージの品質と生産効率を飛躍的に高めたことで、たちまち世界中の半導体メーカーに採用され、事実上の業界標準となりました。その後も、第二次、第三次と「モールドイング革命」を次々に起こすことで、半導体業界の発展に貢献してきました。このように超微細加工技術をはじめとする、他社にはない独自技術の開発に挑んできたことが、今日の事業の礎となっています。

他社が真似のできない技術で、圧倒的な競争優位を築く

これまで、半導体市場は一貫して成長してきたわけではなく、過去には需要が大きく変動したことから、当社の業績が大きく左右されるという試練を何度も味わってきました。そのため、一時の好況に油断することなく、半導体製造における生産性や品質の向上に邁進する過程で競争優位を築き、さらに上の成長ステージをめざしてきたのです。

一方、事業の発展の中では、当社が生み出した技術が模倣されるといった問題に幾度も直面してきました。これについては、特許による権利保護を進めるとともに、他社が模倣できない独自技術の開発に注力してきました。その代表的なものが、モールドイング工程における「コンプレッション成形」の技術です。これは従来の成形方法とまったく異なる発想のもとで開発した成形方法であり、2009年に一号機を納品して以来、すでに10数年が経つものの、いまだに他社の追従を許さない装置となっています。この「コンプレッション成形」は薄型化や高集積化がますます要求される時代にあって、市場ニーズに即した成形技術として圧倒的な競争優位をもたらしています。

以上のような技術開発の歴史を踏まえて、TOWA では新たな技術開発に果敢に挑んでいます。その一つが3次元積層技術への貢献です。3次元積層技術は、さまざまな機能を持つ半導体チップを積み重ねることで、小型化と処理能力および電力効率の向上をめざすもので、封止技術が大きな要になります。当社では、ベルギーの半導体研究機関、imec(アイメック)にモールドイング装置を提供するなどして、3次元パッケージの技術開発に貢献しています。これからも、創業者が抱いたものづくりに対する熱い思いを継承し、常に時代の先頭に立って産業への発展に貢献していきたいと考えています。

長期ビジョンの目標値を2年前倒しで達成

私は2012年に社長に就任して以来、半導体業界に対する貢献と事業の発展を追求してまいりました。その後2014年3月期に売上高171億円、営業利益4.5億円であった中で、10年後の売上高500億円、営業利益80億円、営業利益率16%という大きな目標を掲げました。

当時、モールドイング工程などの市場規模が500億円程度であったことから、社内では売上高の目標500億円に対して懐疑的な見方が多かったのです。しかし、一年、二年と

目標を言い続けたことで、社内の空気が大きく変わってきました。そして、従業員一人ひとりが目標達成に向けた課題を洗い出し、その解決に向けて取り組みだしたことが強く印象に残っております。それによって、不可能と思われた目標が実現可能なものへと変わっていったのです。

おかげさまで、2021年度は半導体の旺盛な需要に応える増産投資や、中国における半導体内製化に向けた積極的な投資が奏効し、コロナ禍という特殊な状況下でありながら、大きく業績を伸ばすことができました。これによって、2021年度の売上高は506.6億円、営業利益115.0億円、営業利益率22.7%を記録し、中期経営計画と「TOWA10年ビジョン」の目標値を2年前倒しで達成することができました。

先の10年ビジョンをスタートした2014年以降、モールドイング市場におけるトップシェアを維持し拡大したのに加えて、急速に拡大している中国市場の需要への対応、市場の変化に柔軟に対応できる生産体制の構築など成し遂げてきました。これによって、2022年3月に策定した新たな長期ビジョン「TOWA ビジョン2032」の着実な実行に向けた経営基盤を築くことができたと自負しております。

「変革で世界の頂へ」をテーマに、10年計画を策定

今日、さまざまな用途で半導体の需要が急増する中で、当社に対するお客様の期待はますます大きなものとなっています。一方で、サステナビリティの実現などの社会課題に世界が直面する中、今後もさらなる成長と企業価値の向上を追求し、世界において他社の追従を許さない唯一無二の企業をめざしてまいります。そこで新たな長期ビジョン「TOWA ビジョン2032」では、「変革で世界の頂へ」をテーマに掲げました。また、長期ビジョンに合わせて、2032年3月期までの10年間で三つのフェーズに分け、それぞれ第一次、第二次、第三次中期経営計画として取り組んでまいります。

10年後の2032年3月期には、売上高1,000億円、営業利益250億円、営業利益率25%をめざします。第一次中期経営計画の3年間は「世界の頂」に向けた基盤強化の期間と位置付け、新技術の開発や生産設備への投資に加えて、TOWAの技術を次世代へ伝承するための人材育成や、事業規模拡大に向けた人材の獲得を積極的に行います。また、事務作業や生産現場の効率化に向けたデジタルトランスフォーメーション(DX)投資なども行います。このため、第

一次中期経営計画では利益率が一時的に低下するものの、第二次中期経営計画以降はこれらの投資効果により、営業利益率は改善していく計画です。

失敗を恐れず挑戦する企業風土をさらに醸成

これからの10年間ににおいても、顧客価値を創出し続ける世界のリーディングカンパニーであるために、創業以来培ってきた、何事にも挑戦する企業風土をさらに醸成することが重要と考えます。そこで私が社内に伝えているのは、「前向きに挑戦することによる失敗やトラブルはウエルカム。どんだん失敗してほしい」という点です。単に言葉で語るだけでなく、失敗を表彰する制度を設けたいと考えました。ただし、社内から「社長、失敗大賞ではだれも応募しません」とのことで、やむなく挑戦を讃える「チャレンジ賞」としました。もちろん、事業において失敗やトラブルは皆無であることが理想です。しかし、今後、イノベーションを加速していく上では、新たなことへの挑戦を通じて、さまざまな失敗やトラブルは避けて通れません。何か問題が起きたときに、その解決に向けて要素技術や設備の改善を図っていくことこそが新たな価値を創出する上で重要と考えます。

かつて私がシンガポールに駐在していた際、お客様に納めた装置が本格稼働前に不具合を生じました。呼び出しを受けてこちらは平身低頭で、内心、本格稼働前でよかったという安堵もありましたが、装置の不具合について状況をすぐに確認し、解決策を理路整然と説明した上で、すぐに対処しましたところ、「さすがTOWAさんですね」とお褒めの言葉をいただきました。トラブルはあってはならないと思う一方、万一の際はただちに対処できる能力があることを、お客様に知っていただくことで、当社グループに対する信頼感が増すと考えます。

それともう一点申しますと、当社グループの従業員は、国内外を問わず何事もお客様の目線を大切に動くことが特長です。たとえば、海外のお客様のもとで装置の据え付けにお伺いした際、それだけを済ませて帰るということはいたしません。すでに納品した装置に問題はないか、お客様が困っていることはないかを必ずお尋ねいたします。そして、ほかの装置に問題があれば、その場で調整いたしますし、解決が難しい場合、本社と連絡を取って対処方法を考え、ただちに実行します。こうした取り組みを誠実かつ迅速に行うのがTOWAであり、それがお客様の信頼につながることを、私たち全員で共有しています。

シリコンサイクルに業績が左右されない、新たな事業を創出

私は1979年に当社に入社して以来、40年以上にわたり半導体の世界に身を置いてきました。この間、シリコンサイクルと呼ばれる好不況に翻弄され、半導体ならぬ「変動体」というべき苦い経験を何度も味わってきました。そのため、好業績に対してはむしろその後の需要減を心配するという危機感を常に抱いています。これから先、シリコンサイクルに業績が左右されないために、新たな事業の柱を築くことが重要と考えます。また、2032年に売上高1,000億円、営業利益率25%を実現する上でも欠かせない取り組みであります。前長期ビジョンにおいては、中核の半導体事業にとどまらず、化成品事業を伸ばしてきたのに加えて、新事業の創出に注力しました。今から約6年前に新事業推進本部を立ち上げ、コア技術を活かして成長戦略の推進に取り組んできました。この中には、TSS（トータル・ソリューション・サービス）事業の強化をはじめ、M&Aによる新規ビジネスの展開、そしてコア技術を応用した新規事業の立ち上げなどを挙げることができます。今年4月からはコア技術事業本部と組織を改編し、体制を強化してさらに事業を成長させていきます。

従来、TOWAは半導体製造装置を製造して、お客様のもとに納品するまでが主な業務でした。これからは既存事業に加えて、超精密金型加工技術を活かした受託製造業（EMS）やサブスクリプションといったビジネスモデルを視野に入れた新たな事業展開を意図しています。この挑戦を「TOWAビジョン2032」の策定を機に始めたいと考えています。

当社グループの強みは、ものづくりの技術とともに、お客様の懐に飛び込んで困りごとやご要望をお聞きする営業姿勢です。新たな取り組みを進めていく上では、お客様が「こんなことをしたい」「困っている」と考えた際、真っ先にお声をかけてくださる、いわば第一ベンダーであることが最も重要と考えます。また、もう一つ重要なことは新たなことに着手するタイミングです。お客様の事業が変わろうとする時期などをしっかり見定めた上で、新しいことに取り組むことが挑戦の成否を大きく左右すると考えています。

また、当社では、約30年前から半導体樹脂封止用金型の加工に用いる切削工具（エンドミルなど）を自前で製造してきました。それというのも、市販の切削工具では当社が手がける超精密金型加工に対応できないからです。近年、社内の需要に加えて、切削工具や受託加工ビジネスの需要が拡

大してきたことから、今年3月には、京都東事業所に新工場を建設し、生産能力を増強しました。いずれは新事業を売上高の3割程度を占める事業に成長させていく考えです。

国内外を問わず、従業員が働きやすい環境を整えるのが経営者の使命

当社は、今日まで経営理念である「クォーター・リード」という考えのもと、世の中にない製品を世に送り出し、お客様に貢献してまいりました。その代表例であるコンプレッション装置は環境負荷が少ない上、樹脂の使用効率100%を達成しており、いわばSDGsへの貢献につながった事例であります。こうした実績を強みとして、今後もESG経営を積極的に推進していく考えです。

特に、社会（S）の面におきましては、技術者をはじめとする人材の育成が重要であるのは申すまでもありません。また、従業員が喜びとやりがいを抱いて仕事に取り組める環境を整えていくのが、経営者の使命の一つと考えます。中でも、若い従業員を育てていくことが不可欠であることから、人材育成の一貫として、できるだけ早い時期にTOWA学校をつくりたいと考えています。

人材基盤の強化は国内にとどまらず、海外の拠点でも同様に進めています。根本的な考え方として、海外拠点は単なるコストセンターではなく、プロフィットセンターであるととらえ、現地の人材の教育研修に注力してきました。おかげさまで、装置の据え付けやメンテナンスなどを現地で完結できる環境が整ってきており、お客様のご要望にスピーディに対応できるほか、コロナ禍において海外出張ができない中でも、現地の従業員によって業務を支障なく行うことができております。

もっとも、受注案件が急増する中で、日本から海外出張に出向く従業員が増えているのも事実です。一度海外に出向くと、感染予防対策の関係から数か月単位の長期にわたる出張となります。それでも、厳しい環境の中でだれもが高いモチベーションのもとで業務に励んでおり、これこそがTOWAの底力と考えます。

「TOWAビジョン2032」の目標達成に向けて邁進

売上高が171億円だった2014年当時、10年後の目標として掲げた売上高500億円に向けては明確な根拠が必ずし

もあったわけではありません。しかし、今回の「TOWAビジョン2032」においては、売上高1,000億円に向けた流れは、私の中ではかなりの確度で実現できると自信をもっています。目標達成への道は決して平坦ではなく、想定外の事態もあり得るものの、いかなる外的要因にも動じることなく、実現に向けて邁進してまいります。

今後、超精密金型加工技術の開発競争は世界規模で熾烈さを増すものと考えます。世界No.1メーカーの地位を確保している半導体モールドイング装置についても、競合他社の追い上げが激しくなることでしょう。これからの20年先、30年先を見すえたとき、当社の技術が他社に追いつかれたり、簡単に模倣される程度にとどまるのであれば、明るい未来はないと考えます。しかし、TOWAには創業以来、培ってきた「ものづくり企業の真価に挑む」情熱があります。競争を恐れるのではなく、むしろ前向きにとらえ、現在の競争優位をさらに高めて、TOWAにしかできないものづくりを追求してまいります。直近の中国への大型投資にしても、単なるコストセンターとしての工場でなく、付加価値を生み出すプロフィットセンターとしてとらえ、将来の持続的成長を見すえた拠点の一つとして育てていく考えです。

ものづくり企業として、我々はこれからも何事についても真面目、誠実、堅実に取り組んでまいります。投資家の皆様からすると、地味に思われるかもしれませんが、これまで培ってきたTOWAの良き伝統を守る一方、時代の先を見すえた新たな挑戦を通じて、TOWAにしかできないものづくりの技術を追求していく考えです。そして、企業と社会がともに成長できる高い付加価値を生み出してまいります。つきましては、ステークホルダーの皆様におかれましては、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。



02

TOWAグループの歴史

TOWAは、勃興期の半導体産業と共に歩んできました。当社の歴史は技術革命の歴史であり、1979年の創業から、エポックメイキングな技術革命を通して成長を続けてまいりました。その端緒を開いたのがマルチプランジャの開発です。以来、常にこの業界で先陣を切って新技術、新製品を世に生み出し続けています。

》1979

第1次モルディング革命

業界標準の確立

▶マルチプランジャの開発

技術革命 1 マルチプランジャモールドの登場

複数の小サイズ樹脂にて注入する自動成形方式で、流路短縮により品質向上と樹脂ムダ低減を実現しました。

創業当初のマルチプランジャモールドシステム



》1995

第2次モルディング革命

Yシリーズの爆発的ヒット

▶モジュールシステムの開発

技術革命 2 モジュールシステム(Yシリーズ)がベストセラーに

モジュール連結でプレスが増減が可能となり、それが後工程における時代のニーズに合致。自社のみならず半導体製造のデファクトスタンダードにして、業界の成長に貢献しました。



Yシリーズ

海外生産によるコスト低減

▶海外生産拠点の本格的立上げ

1991年 株式会社バンディック(3月)、Micro Component Technology Malaysia Sdn. Bhd.(現TOWAM Sdn. Bhd.)(4月)を子会社化

1991年3月 京都東事業所を新設

医療分野に進出
▶ファインプラスチック成形品

1998年3月 本社・工場が完成し移転

1998年12月 九州工場(現九州事業所)を新設

》2009

第3次モルディング革命

新たな業界標準の確立

▶コンプレッション装置の市場投入

技術革命 3 コンプレッション成形方式で最先端製品に対応

TOWA独自のコンプレッション(圧縮)成形方式により、樹脂流動が無く最先端製品の成形を可能に。低コスト化、CO₂削減にも貢献します。



PMC2030-D

グローバル・サービス体制の確立

▶海外各拠点でフィールドサービスを開始

2002年6月 中国にTOWA半導体設備(蘇州)有限公司を設立

ITバブル崩壊

リーマンショック

2013年4月 ソウルにTOWA韓国株式会社を設立

Samsung子会社のモールド事業をM&A
▶Samsung第1ベンダーの地位を獲得

2015年10月 TOWA韓国がSEMES Co.,Ltd.のモルディング事業を譲受

2018年8月 オムロンレーザーフロント株式会社(現 TOWAレーザーフロント株式会社)の株式を取得し子会社化

2018年10月 中国南通に東和半導体設備(南通)有限公司が設立され、11月に精技電子(南通)有限公司の金型製造事業を譲受

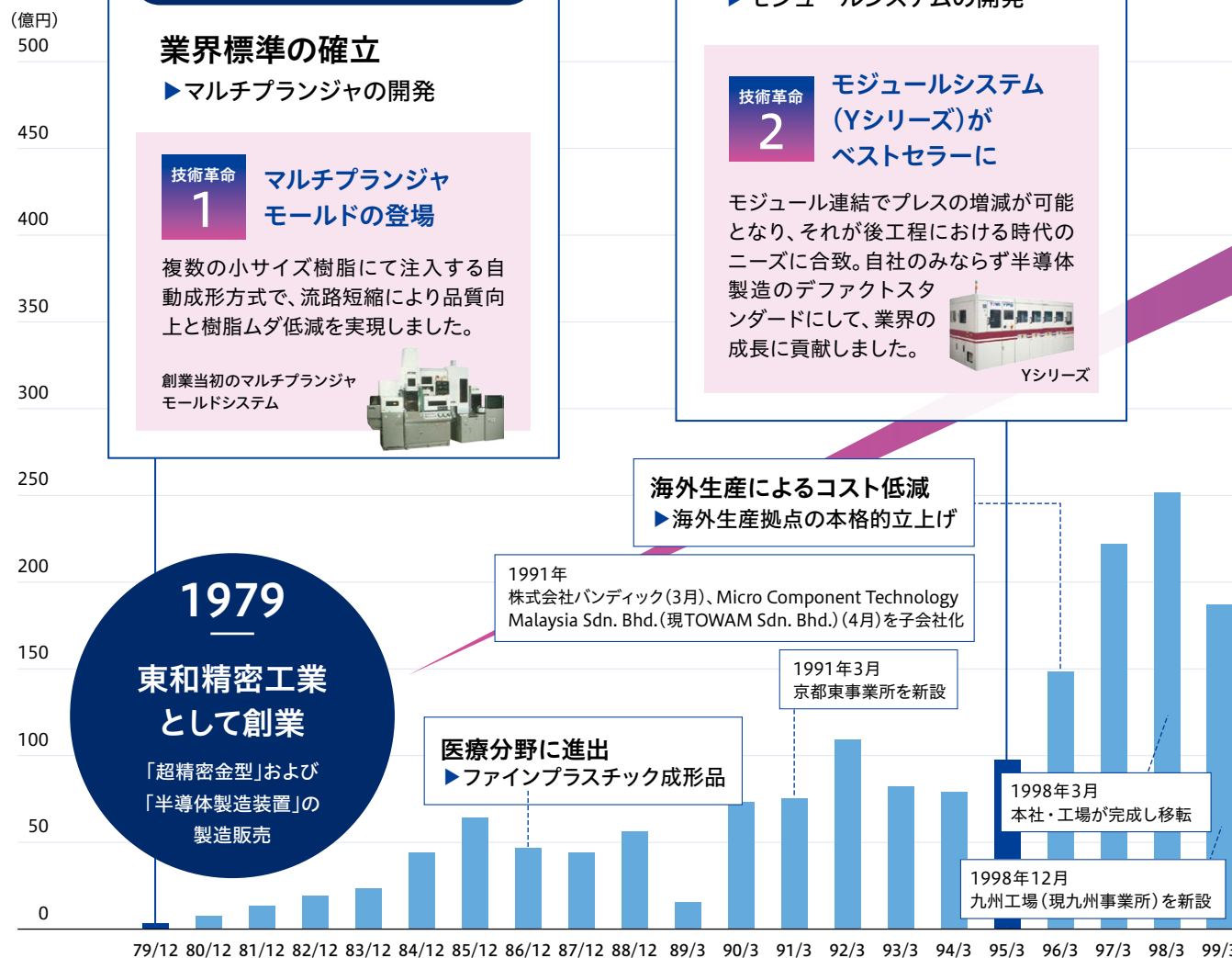
レーザ加工装置事業をM&A
中国金型事業をM&A

2022年1月 Fine International Co., Ltd.の株式を取得し子会社化

2021年9月 中国に東和半導体設備研究開発(蘇州)有限公司を設立

2021 変革で世界の頂へ

他社の追随を許さない
唯一無二の企業



1979
東和精密工業として創業
「超精密金型」および「半導体製造装置」の製造販売

1979年4月 創業

1996年9月 大証2部上場

2000年11月 東証1部上場

2014年3月 TOWA10年ビジョン発表

TOWAグループの培った強み

TOWAには、ものづくりにかける思いをひたむきに研究・開発に注いだ先人たちが、長年かけて築いてきた技術基盤があります。この基盤を最大の強みとして、アフターサポートをはじめとするトータルソリューションサービスを拡充。同時に、販売・生産拠点を世界に拡大し、昨今の部材不足でも生産力、競争力を損なわない調達・製造・供給を実現しています。

- コア・コンピタンス ～ 超精密金型を創出してきた金型関連技術
- 市場ニーズを先取りするソリューション提案型の開発



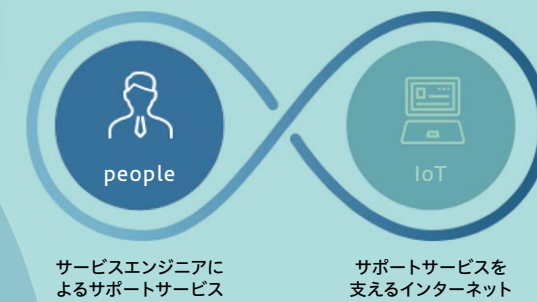
テクノロジー

TOWAの成長を支える三つの強み

サポート & サービス

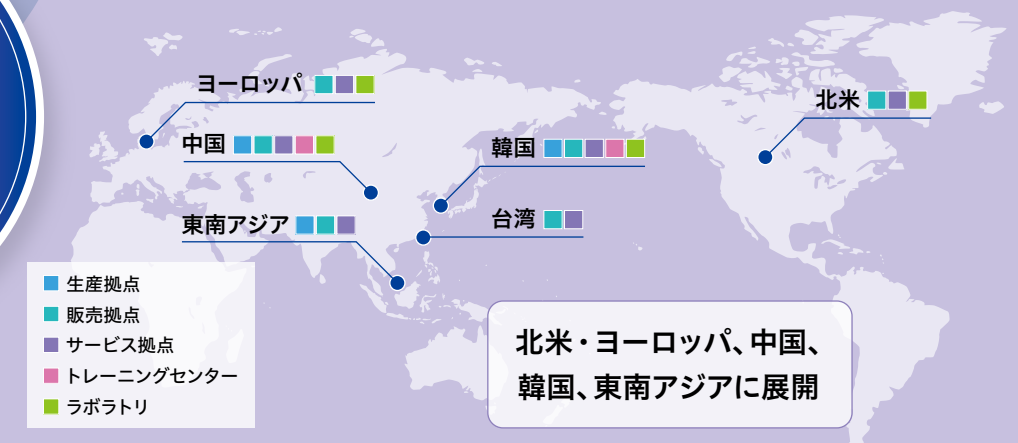
- Total Solution Service (TSS)
 - サポートサービス
 - 生産性向上サービス
 - 部品供給サービス
 - 付加価値提案
 - サポートシステム TEN-System

- トレーニングセンター
- ラボラトリ



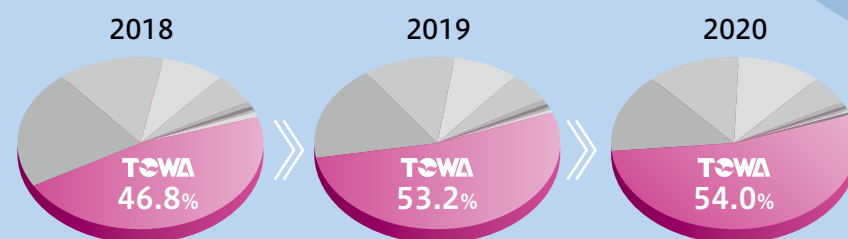
グローバル展開

- 主要な半導体生産地域に販売拠点および生産拠点を展開
- 市場変化に柔軟に対応できるサービス体制を構築



数字で見る TOWAの現在地

半導体モルディング装置世界シェアの推移



※VLSI Research社のデータをもとに当社作成

TOWAグループの技術と製品

TOWAグループにおける最大の強みは技術です。特に半導体製造の後工程では最先端技術を世界に発信し続けてきました。原点は、超精密金型のモジュールシステムの開発であり、そこで培われた超精密微細加工技術が、化成品事業や新事業への足がかりとなりました。いまだ他社の追従を許さないコンプレッションモールドはじめ、多彩な技術が世界のテクノロジーの発展に役立っています。

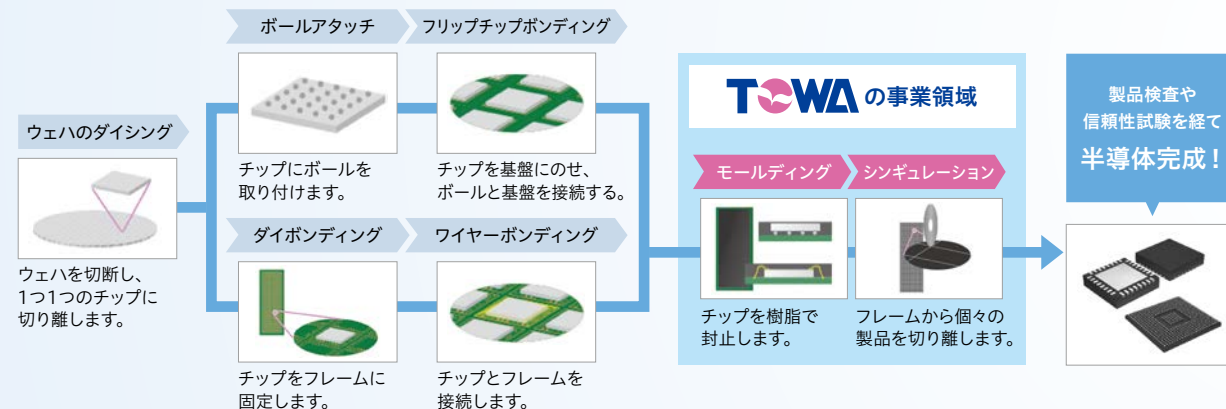


半導体

半導体製造における後工程の革命的ソリューション

前工程と後工程について

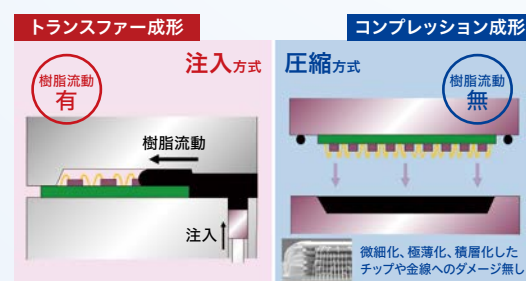
半導体の製造には前工程と後工程があり、当社は後工程専用の装置を製造するメーカーです。後工程は、半導体のチップを並べて金線をつなぎ、樹脂で閉じ、カットしてテストを行うというもので、パッケージングともいいます。チップを樹脂で覆う(=封止する)工程をモルディング、カットする工程をシンギュレーションといい、当社ではこれらの装置の性能を徹底的に追求してきました。



モルディングで圧倒的地位を築いたコンプレッション装置

モルディングには従来、樹脂を横から注入するトランスファー成形という方法が使われていましたが、注入時の樹脂の流動で金線が歪み、デリケートなチップにダメージを与えるという問題がありました。それを解決したのが独自のコンプレッション装置です。樹脂の中に浸すことで流動の影響を取り除いたコンプレッション(圧縮)成形方式により、最先端製品の封止と大幅なコスト削減が可能となりました。

コンプレッションモールドは、2.5D、3Dパッケージなどの次世代パッケージに最適であり、自動運転、5G、AI、IoTなどの次世代技術で加速的に拡大する半導体需要を見込んだ成長が期待できるため、当社の技術的な拠り所となっています。



トランスファー成形→コンプレッション成形によるパッケージソリューション。メモリなどのハイエンド製品にコンプレッション成形は欠かせなくなっている。

急激に伸長中のシンギュレーション装置

モルディング工程で封止されたパネル状の半導体をつつひとつの個片に切り分けるのがシンギュレーション装置です。当社の装置は1mm×1mmの個片化が可能で、業界最小を誇ります。

当社は業界に先駆けてシンギュレーション装置の製造を開始しましたが、ここ最近極めて顕著な成長を見せており、モルディング装置と共に半導体事業において重要な位置を占めるようになってきています。今年度は省人化を進めた新機種の開発を行い、新たな顧客獲得を目指しております。



化成品

ナノテクを生かしたプラスチックの成形加工で医療に貢献



化成品事業は医療機器が中心となっており、医療注射器、点滴用部品、癒着防止スプレー用キットなど医療用ファインプラスチック成形品が主なラインナップです。独自の超精密・微細加工技術で製作された金型による高精度な量産成形と、クリーンルーム設備での「射出成形～組立」をコア技術とした検査・出荷までワンストップでの生産が特徴です。

特に癒着防止スプレーは、術後の内臓器官同士の癒着を防止し、合併症を防ぐ医療機器で、医療技術の進歩に伴ってニーズが増大しています。



新事業

TOWAのコア技術を応用した新規事業の展開

金型の超精密加工技術を支える自社開発のエンドミル(工具)の販売、超精密加工技術やコーティング技術を応用した受託加工ビジネス、当社半導体製造装置のアフターサービスや改造・修理、中古機の販売までトータルで提案するTSS事業を展開しています。



TOWAグループのビジネスモデル

さまざまな用途で半導体需要が急増する中、TOWAに対するお客様の期待はますます大きくなっております。サステナビリティの実現などの社会課題に世界が直面する中、今後もさらなる成長と企業価値の向上を追求し、当社にしかできないビジネスモデルを構築して唯一無二の企業をめざします。

TOWAの強み

テクノロジー

超精密金型をTOWAの原点とし、半導体製造の後工程における革命的なソリューションを発信。

- コア・コンピタンス～超精密金型を創出してきた金型関連技術
- 市場ニーズを先取りするソリューション提案型の開発

サポート&サービス

お客様の生産環境を人とIoTで支える総合的なサポートサービスを提供。

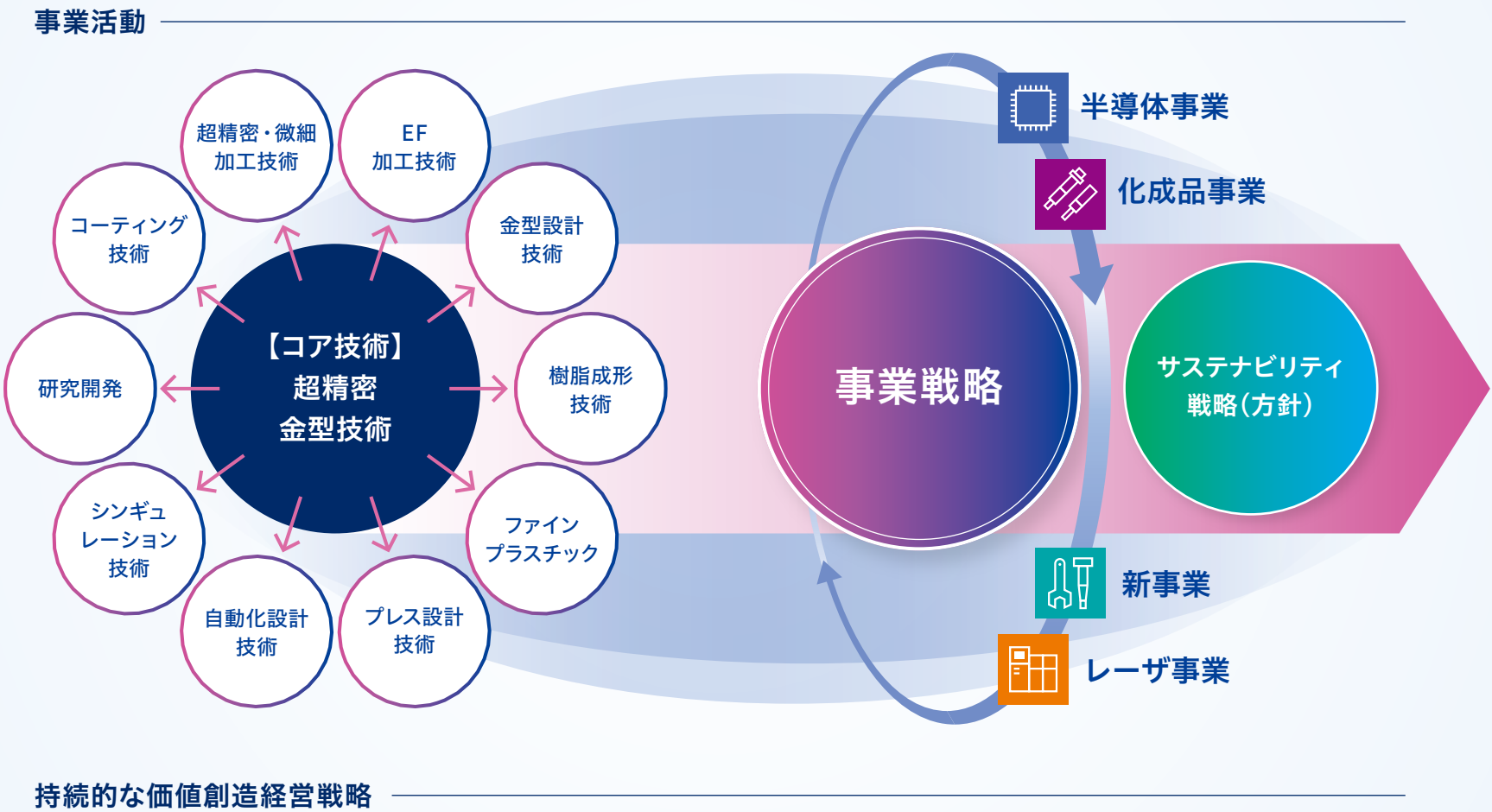
- Total Solution Service(TSS)
- トレーニングセンター
- ラボラトリ

グローバル展開

生産・販売・開発拠点を設立し、現地のニーズに対応。

- 主要な半導体生産地域に販売拠点および生産拠点を展開
- 市場変化に柔軟に対応できるサービス体制を構築

ビジネスモデル



ありたい姿

長期ビジョンメッセージ

- 1 パッケージングプロセス提案により顧客価値を創出し続ける世界のリーディングカンパニー
- 2 TOWAの技術でサステナブルな社会を実現する会社
- 3 積極的な情報発信で知名度の高い会社
- 4 企業文化の伝承と多様な価値観を尊重する笑顔で働ける会社

「TOWAビジョン2032」の達成目標

売上1,000億円と高利益率の達成

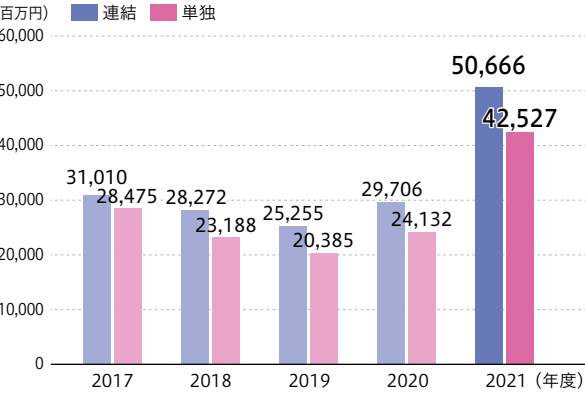
2032年3月期目標数値

- 売上高 1,000億円
- 営業利益 250億円
- 営業利益率 25.0%

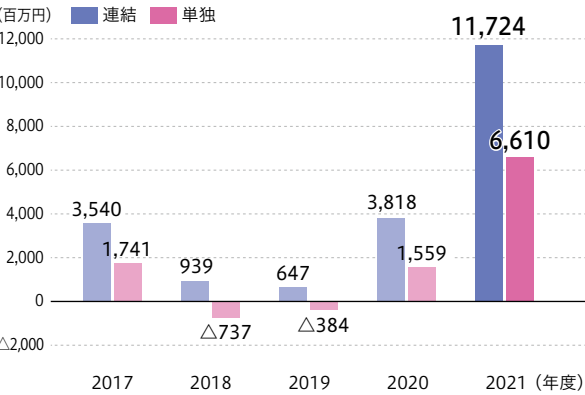
財務・非財務ハイライト

財務ハイライト

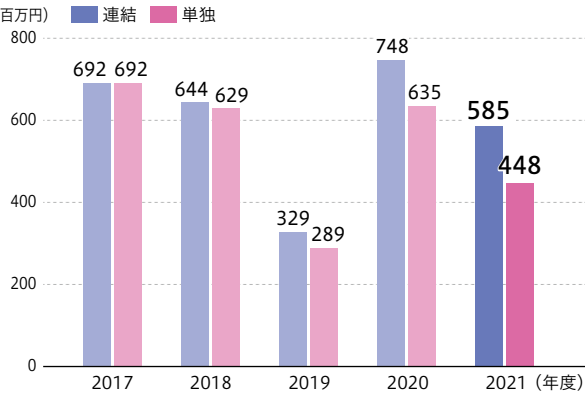
売上高



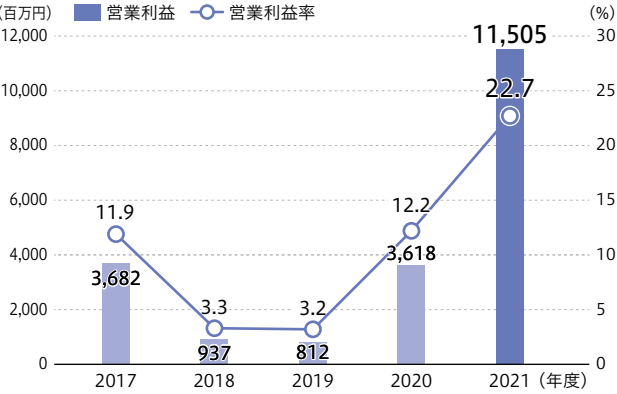
経常利益



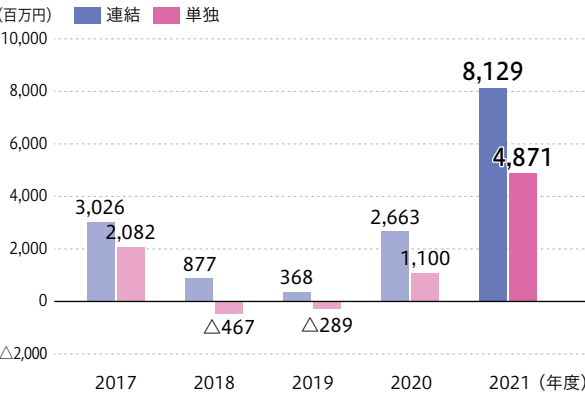
研究開発費



営業利益／営業利益率(連結)

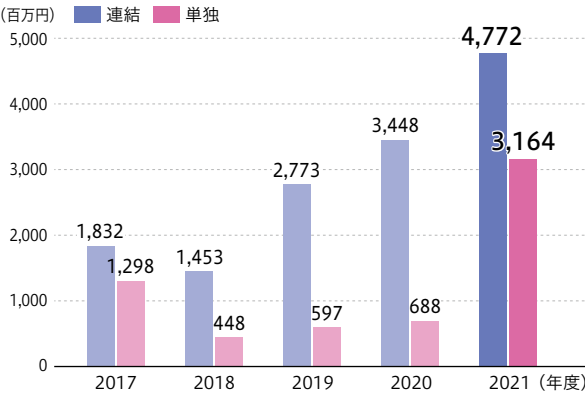


当期純利益



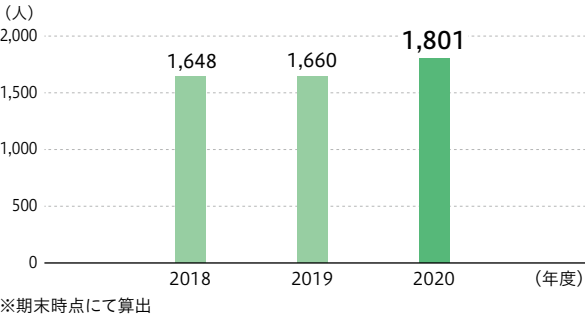
※連結については、親会社株主に帰属する当期純利益を記載しております。

設備投資

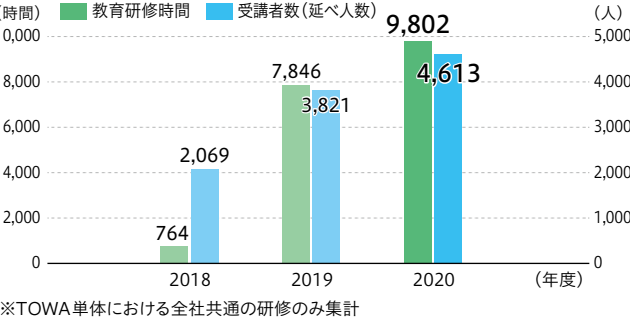


非財務ハイライト

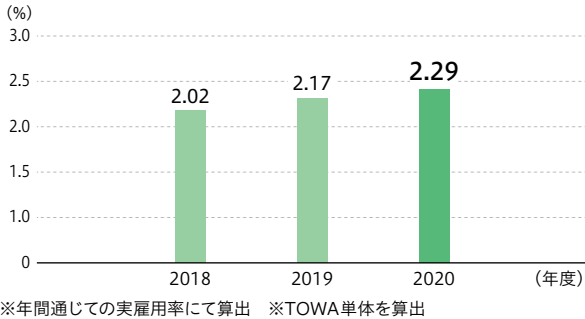
連結従業員数



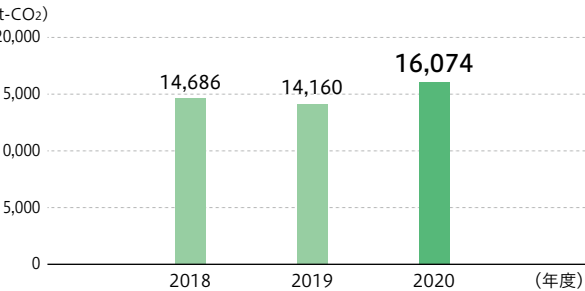
教育研修時間と受講者数



障がい者雇用率

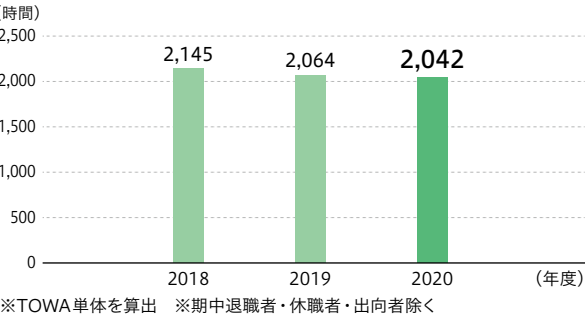


CO₂排出量

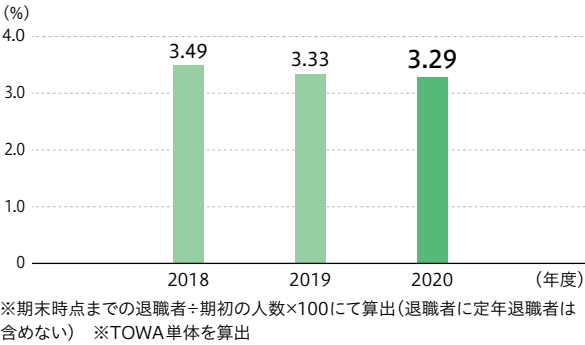


国内のグループ会社を含む5つの拠点と、海外グループ会社の4つの生産拠点の合計。CO₂への換算係数は、国内電力は環境省の「電気事業者別排出係数一覧」、韓国は韓国電力の公表値、その他の地域はIEA発行のEmissions Factorsを使用。燃料は、国内ガス会社の公表値、および環境省の「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」を使用。

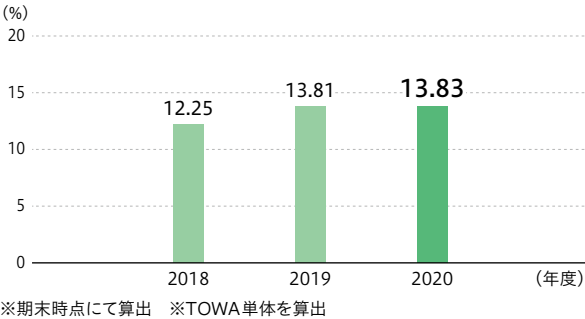
一人当たりの総労働時間数



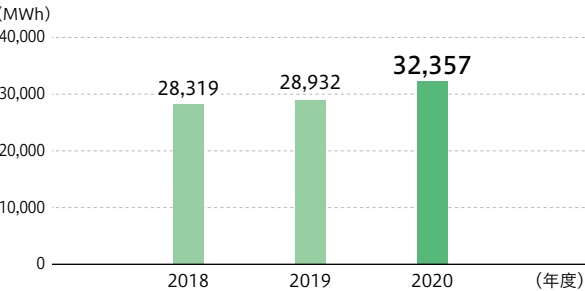
正社員の離職率



女性従業員割合



電力使用量



国内のグループ会社を含む5つの拠点と、海外グループ会社の4つの生産拠点の合計。

03

長期ビジョン「TOWAビジョン2032」

世界において他社の追随を許さない唯一無二の企業になるため、パラダイムシフトを図り、これまでと全く違った一段高いステージへ上がるため、10年後に向けた新たなチャレンジ、長期ビジョン「TOWAビジョン2032」を策定しました。

前長期ビジョンの振り返り

「売上高500億円、営業利益80億円」を2年前倒して達成

売上高約171億円、営業利益約4.5億円だった2014年3月、「10年後に売上高500億円、営業利益80億円、営業利益率16%」という大きな目標を掲げました。達成に向け、市場動向を先読みしつつ積極的な設備投資を行った結果、2022年3月にその夢が2年前倒して実現しました。



前長期ビジョンにおける事業ごとの振り返り

事業規模拡大を見据えて投資を行い、モールディング市場におけるトップシェアを維持してきました。

半導体事業

- **モールディング市場におけるトップシェアを維持**
 - ・自社ラボの設置、国際研究機関への参画、コンプレッション装置市場の拡大、革新的な製品の発表などで、TOWAの存在感を高めた
- **急速に拡大する中国市場の需要に対応**
 - ・営業、設計、生産、据付、アフターサポートまでを中国国内で完結できる体制を構築、新規顧客を獲得
- **市場変化に柔軟に対応できる生産体制を構築**
 - ・設備投資により生産能力を大幅に増強
 - ・増産対応(先行生産)と在庫適正化(受注後生産)を両立

新事業およびレーザ事業

- **TSS(トータル・ソリューション・サービス)事業を強化**
 - ・韓国Samsung社のグループ会社よりモールディング事業を譲受
- **M&Aによる新規ビジネスの展開**
 - ・オムロンレーザフロント社の株式を取得、レーザ加工装置事業譲受
- **TOWAのコア技術を応用した新規事業を開始**
 - ・自社開発のエンドミル(工具)の販売を開始
 - ・コア技術を応用した受託加工ビジネスを開始

化成品事業

- **受注・売上**
 - ・クリーンルーム内での一貫生産設備を生かし新規顧客を開拓
 - ・微細加工技術と射出成形技術を融合し新たな市場を開拓
- **生産体制**
 - ・厚労省許可機関より高度管理医療機器(クラスIV)製造所として承認を取得し、アドスプレーの生産開始
 - ・ISO13485(医療機器-品質マネジメントシステム)を取得

ESG

- 環境性能の高いコンプレッション装置を拡販
- 国内主要拠点での使用電力を全て再生エネルギー・太陽光発電設置推進
- 定年後も報酬水準が変わらない新たな再雇用制度を創設
- 社外取締役(女性)を増員
- 独立性の高い指名・報酬委員会を設置

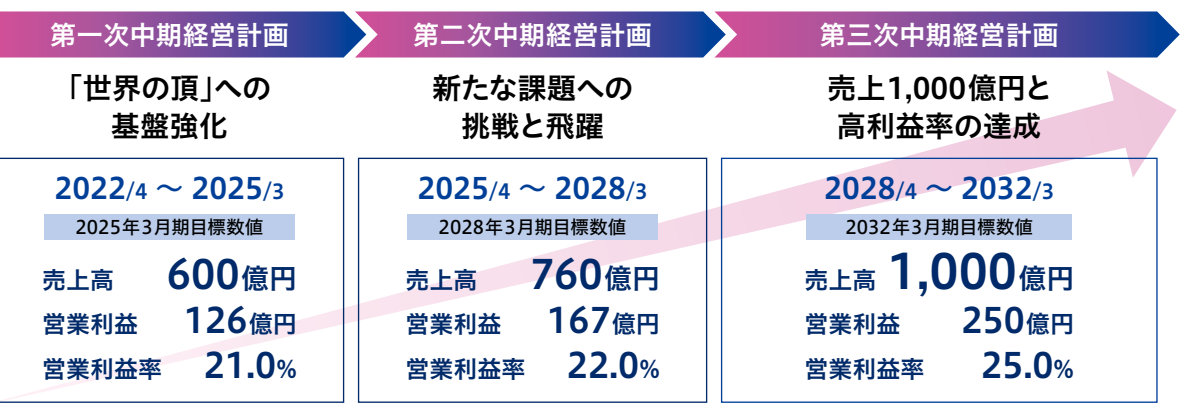
株主還元

- 安定継続配当を維持出来る財務基盤を確立
- 事業規模拡大にともない株主還元も強化

長期ビジョン「TOWAビジョン2032」

テーマ「変革で世界の頂へ」

世界の頂とは、文字通り世界のトップであり、他社の追随を許さない唯一無二の企業になることです。そのために段階的に達成すべき目標を設定するとともに、今後TOWAがどのような企業であるべきかを改めて問い直し、10年後のTOWAの「ありたい姿」を4つの目指すべきポイントに整理して決めました。



TOWAビジョン2032の業績目標において、当社は10年後の2032年3月期に、売上高1,000億円、営業利益250億円、営業利益率25%を目指します。最終目標の達成に向け、2032年3月期までの10年間で三つのフェーズに分け、第一次～第三次中期経営計画として取り組んでまいります。最初の3年間は、「世界の頂」への基盤強化を行う期間

と位置付け、新技術の開発や生産設備への投資に加えて、TOWAの技術を次世代へ伝承するための人材育成や、事業規模拡大に向けた人材の獲得を積極的に行います。効率化を図るためのDX投資なども行うため、第一次中計では一時的に利益率が低下しますが、第二次以降はこれらの投資効果により、営業利益率は改善する計画です。

10年後(2032年)にTOWAがしたい姿

1	パッケージングプロセス提案により顧客価値を創出し続ける世界のリーディングカンパニー	TOWAの誇るパッケージングプロセスに係る技術、ノウハウを提供することにより、お客様が得られる価値を創出します。
2	TOWAの技術でサステナブルな社会を実現する会社	TOWAの技術を様々な分野に活かし、持続可能な社会の実現に貢献します。
3	積極的な情報発信で知名度の高い会社	人材確保やBtoCを視野に入れた新たな事業展開においては、広く社会全般における知名度向上が必要と考え、積極的なPRに努めています。
4	企業文化の伝承と多様な価値観を尊重する笑顔で働ける会社	培ってきたDNAを10年後も伝承するとともに、時代の変化に応じた多様な価値観を認め、柔軟な対応で社員を大切にすることを目指します。

第一次中期経営計画(2022/4～2025/3)

TOWAは、「装置・金型」を納めてお客様から代金をいただくまでで完結していたこれまでのビジネスから変革を図り、「製品を納めてから始まるビジネス」の確立を目指します。具体的には、TOWAが半導体パッケージングプロセスにイノベーションをもたらし、より効率的な生産プロセスを提供・ギャランティーし、そこから対価を獲得するビジネスの創出を目指します。

「TOWAが創り出すプロセスイノベーション」をテーマに、世界の頂への基盤強化を図ります。

第一次中期経営計画は、2022年4月から2025年3月までの3カ年計画です。3年後、売上高600億円、営業利益126億円を目指します。この3年間は、長期ビジョンを達成するための基盤強化の期間にしたいと考えています。

第一次の数値目標～長期ビジョン達成のための基盤強化

第一次中期経営計画 世界の頂への基盤強化					
2022/4 ～ 2025/3 2025年3月期目標数値					
売上高	600億円	内 訳			
営業利益	126億円				
営業利益率	21.0%				
		(単位：億円)	2023/3期	2024/3期	2025/3期
売上高			550	570	600
半導体事業			420	425	440
化成品事業			19	20	22
新事業			86	100	112
レーザ事業			25	25	26

第一次中期経営計画・5つの基本方針

1	パラダイムシフトにより保有する技術・品質・プロセス(ノウハウ)の付加価値をビジネス化し収益力を高める	発想を転換し、「モノを売る」にとどまらず、TOWAの付加価値を売るビジネスを展開します。
2	DXの活用によりスループットを最大化し市場競争力と財務基盤の強化を図る	売上の増大、在庫低減と売掛金回収の早期化、リードタイムや開発期間の短縮、材料費・外注費・経費の低減などに徹底して取り組みます。
3	コア技術を根幹に新たな事業と収益の拡大を図る	引き続き、超精密加工、微細加工、コーティング技術など、TOWAが保有するコア技術を活用します。
4	多様性に富んだ挑戦思考を持ち次世代をリードする人材の育成を図る	前10年ビジョン達成の大きな要因となった「人」の育成について、今後さらに、1,000億円企業にふさわしい挑戦思考を持った人材を生み出していきます。
5	SDGs・ESGへの積極的取組みにより企業価値の向上を図る	サステナビリティ基本方針に基づき、地球環境への影響や、地域・国際社会とのつながり、あらゆるステークホルダーの安心と健康に配慮した活動を行います。

事業戦略

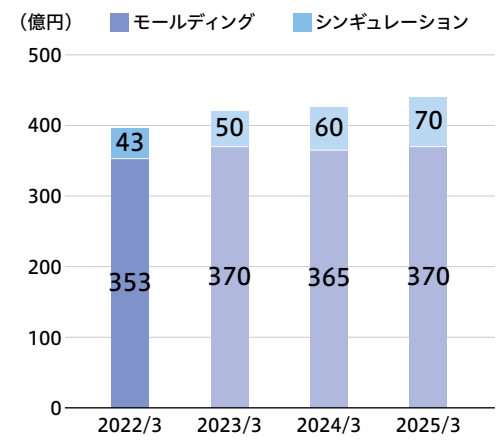


半導体事業

コンプレッション技術などのTOWA独自の技術や、モールドイング装置のリーディングカンパニーとして培った知識や経験を生かし、それらの付加価値をビジネスに展開してまいります。

戦略1	付加価値を生かしたプロセスビジネスの展開により、半導体事業の収益力を強化します。
戦略2	リードタイム短縮および在庫削減を目的とするMIP (Minimal Inventory & Period)により、生産体制・財務基盤の強化を図ります。
戦略3	開発リソースへの積極的な資源投入により、顧客ニーズの先取りやSDGs・ESG投資に適った製品開発を、スピード感を持って実行いたします。
戦略4	シンギュレーションとブレードの連携によって市場を獲得します。

半導体事業の売上目標

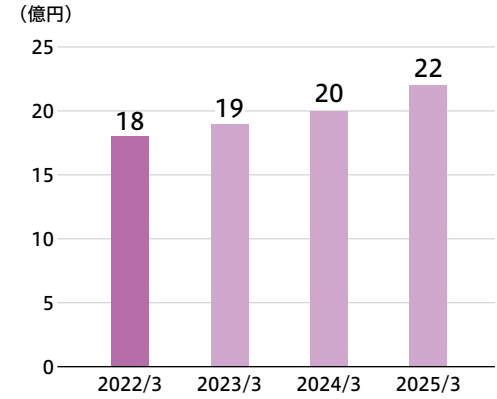


化成品事業

培ったコア技術をもとにブランドの付加価値を高め、医療機器のライセンスを生かして商品の多様化を図ります。当事業は医療現場に深く関わっており、品質・コスト・納期が高い水準で求められるため、これまで以上に品質・コスト・納期を追求し、安定した収益体質を構築いたします。

戦略1	化成品事業で培ったコア技術をもとにTOWAブランドの付加価値を高め事業規模を拡大します。
戦略2	品質・コスト・納期を更に追求し安定した収益体質を構築します。
戦略3	医療機器のライセンスを生かし、商品の多様化を図ります。

化成品事業の売上目標



事業戦略

新事業

超精密加工や微細加工、コーティング技術などのコア技術を応用しTOWAオリジナル商品の創出を目指します。同時にTSS(トータル・ソリューション・サービス)事業の拡大も図ります。またグローバル展開する生産拠点を活用し、技術面だけでなくコスト面でも競争力を高めてまいります。

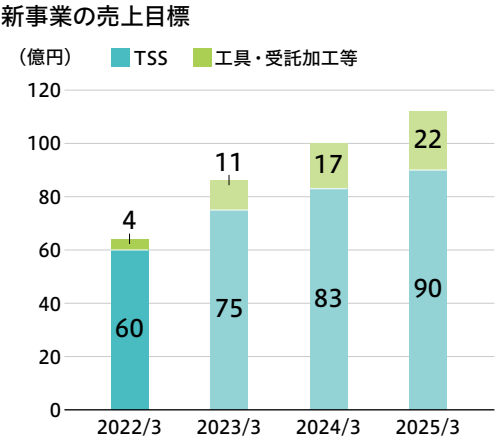
- 戦略1

コア技術の応用展開により新たな柱となる事業を独立させ、ポートフォリオの変革を図ります。
- 戦略2

TOWAオリジナル商品の創出により新たな事業化を実現します。
- 戦略3

TSS事業を通じてお客様の安定稼働に貢献し、長期的関係を確保します。
- 戦略4

グローバル生産拠点を活用した原価低減により競争力強化とシェア拡大を図ります。



レーザ事業

メーカーとして、これまでにない製品やこれまでよりも良い製品を生み出すことは当然ですが、それが価値(利益)を獲得できなければ企業活動としての意味は大きく下がります。当社は、レーザ事業の技術やノウハウを強化し、新商品を創出するとともに、価値の獲得を目指します。

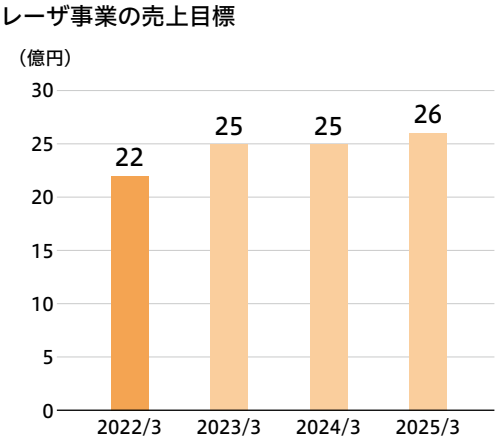
さらに、顧客が求める価値や、その価値の方法などへの理解をさらに深め、顧客の課題を解決を行う提案型ビジネスが出来る企業を目指します。

- 戦略1

アプリケーション強化により新商品を創出し、「価値創造」と「価値獲得」を図ります。
- 戦略2

TOWAグループの生産・販売拠点を活用し生産能力アップ・原価低減と販売体制・サービスの強化を図ります。
- 戦略3

顧客プロセスを徹底追求し、課題解決型ビジネスができる企業へ成長していきます。



機能別戦略

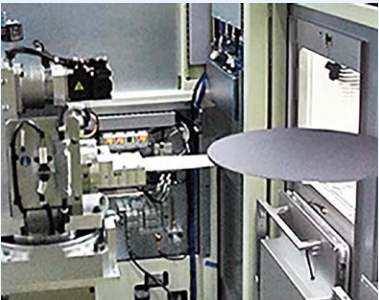
販売戦略

- 1
- プロセスサポートを強化し当社技術でしか生産できないビジネスモデルの構築による販売拡大と収益力の向上
- 2
- 当社独自技術のコンプレッション装置による活用範囲の拡大
- 3
- グローバル販売・管理体制・サービス体制の強化による顧客満足の向上



開発戦略

- 1
- パラダイムシフトによりお客様のニーズに沿った新製品を開発する
- 2
- モールドプロセス開発と次世代モルディング革命によりディファクトスタンダードを確立
- 3
- SDGs・ESGを意識した環境型開発の推進



生産戦略

- 1
- グローバル生産・購買体制の最適化による原価低減およびリードタイムの短縮
- 2
- 生産技術の向上により品質の信頼性を高める
- 3
- DXを活用した高付加価値の製品生産に取り組む
- 4
- 変化する環境(リスク)に対応できる人材の育成と事業構造の構築



人材・組織戦略

- 1
- プロセス開発からソリューション提案まで行うTOWA拠点のグローバル展開
- 2
- 次世代をリードするグローバル人材の育成
- 3
- DXによる業務効率化により働き方改革を推進
- 4
- TOWA技術の伝承のためのTOWA学校の創設



世界初の大判パネル装置CPM1180 最先端半導体への貢献

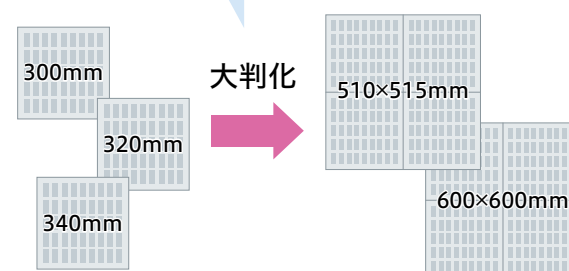
高性能、軽薄短小化、低コスト化を実現する モールドング装置の開発

ウェハ、パネルは大判化が進んでいる

スマートフォンやウェアラブル機器のアプリケーションプロセッサ、指紋センサなどの圧力センサ、サーバーやクラウド、5G通信ネットワークなどの最先端の機器に使われる高性能・高機能な半導体のニーズが高まるにつれ、半導体パッケージもそれに対応していく必要があります。これらの機器や製品は世界中で大量に使用され、特にミドル/ローエンドの製品については、強く低コスト化が求められます。

顕著な変化が、ウェハやパネルの大判化です。1枚当たりで取れるパッケージ個数が増えるため、大幅なコスト削減が可能となるからです。近年ではますます大型化が加速し、超大型パネルが求められるようになりました。

低コスト化・生産性向上を求めて、
ウェハとパネルのサイズは大判化しています。



ラージパネルを可能にしたCPM1180を市場へ

そこで、当社独自のコンプレッション技術とノウハウを駆使して開発に取り組んできたのがCPM(コンプレッションパネルモールド)シリーズで、大判パネル(ラージパネル)のモールドングを可能にする装置です。特に2016年に新発売した「CPM1180」は、660mm×620mmの超大判パネルと直径450mmのウェハを成形することができ、生産効率と低コスト化を飛躍的に向上させることに成功しました。

当社が開発したコンプレッションモールドング装置は、独自の圧縮(=コンプレッション)方式により、樹脂の流動がほとんど起こらないため、微細化、極薄化、積層化したチップや金線へのダメージがなく安定して高品質な成形ができるという大きな特長があります(P.15も参照)。



業界初の超大判成形のフルオート化を実現したCPM1180

大判化に対応するための難題を、技術とノウハウでクリア

FO-PLPは、ウェハよりも大きなパネル(パネル状のキャリア基板)に適用したパッケージング技術です。半導体チップとプリント配線板をつなぐ再配線層(RDL)を、半導体工程を使って作るパッケージの一種で、パッケージの面積を拡大し、チップの外側まで端子を広げて(fan out)います。異種チップ間の接続も可能であり、さまざまな機能を盛り込んだ高性能な半導体製品をつくることができるという、メリットの多い手法です。

一般的にモールドングの大型化には技術的に難しい問題が多いのですが、当社のコンプレッションモールド技術と装置はそれらをクリアし、お客様にご満足いただいています。



POINT 1

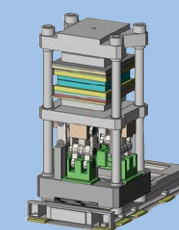
パッケージ厚み精度の確保

FO-PLPは基板レスによる薄型化が特長の一つです。とはいえ600mm角を超えるパッケージサイズで要求される厚み精度を実現するのは難しく、樹脂材料を金型に供給する量の精度は、パッケージ厚みの高精度化にとって重要な要素です。量、樹脂粒径の調整に加え、前工程の情報を考慮するなどの技術とノウハウが詰まっています。

高精度・高剛性なプレス

ミクロン単位の調整構造

均一な樹脂供給



POINT 2

高精度なパッケージング平坦度の確保

パッケージが大きくなればなるほど、パネルの厚みを均一に保つことが難しくなります。当社では高精度・高剛性なプレス、ミクロン単位の調整構造、均一な樹脂供給によって、極めて精度の高い平坦度を実現しています。また、熱履歴の管理や高度なハンドリング技術によって、大判ゆえに生じるたわみ、反り、割れを防止しています。



POINT 3

高度なクリーン環境の確保

装置は、クラス1000のクリーンルーム対応も可能です。樹脂封止プロセスにはさまざまな発塵源があるため、クリーンルーム内に設置するには大きな困難が伴います。装置内のパーティクルを装置からクリーンルーム内に出さない設計をしています。



POINT 4

広い専用工場の確保

お客様の自動搬送化された専用工場だけでなく、装置の製造にも大きな工場が必要です。当社は、2019年からマレーシアのTOWAMで当社最大規模のペナン新工場の建設に着手し、2020年に稼働させました。グループの成長をけん引する大判サイズパネル、ウェハ対応の半導体樹脂封止装置の組み立てなどを行う基幹工場となっています。

2020年末にCPM1180を納入した韓国の大手半導体パッケージングメーカーでは、FO-PLPの量産化に世界で初めて成功し、半導体の市場で大きな関心を集めています。今後もニーズを注視しながら、高精度化、低コスト・高生産性への対応を検討してまいります。

開発から、試作、生産、サポートまで体制整え、中国需要取り込みへ

初の海外開発拠点・東和半導体設備研究開発(蘇州)有限公司

中国では半導体需要が急速に伸長

2021年9月、中国における半導体製造装置事業のさらなる強化を目指す、当社グループ初となる技術開発に特化した新会社「東和半導体設備研究開発(蘇州)有限公司(TOWA-SRD)」を蘇州工業園区内に設立しました。

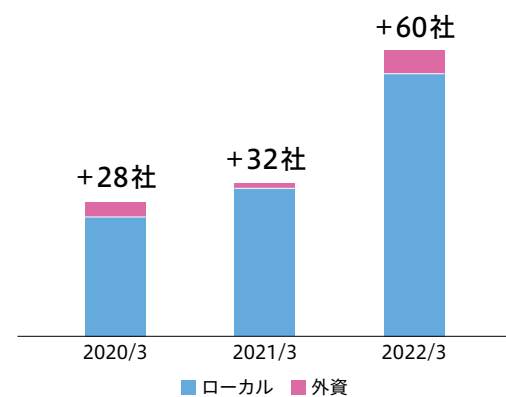
世界的な半導体需要拡大の中でいかにお客様のニーズに応えていくか、半導体製造装置メーカーである当社にとっては重大なミッションです。

顧客開発製品のプロセス評価においては、従来のラボ機能を活用して応えてきましたが、とりわけ今、設備開発でも市場のニーズが高まってきました。そのため、従来の生産業務から、開発対応の要請が強まっています。

中国では、米中貿易摩擦などを背景に、政府の後押しによって半導体の内製化が進んでおり、生産需要が急速に高まっています。中国のお客様により近い場所に拠点を設けることで、開発から製造、供給を効率化できると考えました。

中国地域新規顧客数

直近3年間で120社増加



お客様と共に開発できる拠点を設立

中国での事業活動を強化していくに当たり、4つの柱を掲げました。これらを実行するため、研究開発拠点の一つとしてTOWA-SRDをスタートさせ、従業員一同、業務に励んでいます。

TOWA-SRDでは、主力の半導体製造用精密金型やモールドリング装置の開発、設計を手掛けています。半導体産業の増強が図られる中国では、関連企業の新規参入も相次ぎ、半導体製造装置の引き合いが年々増えています。

当社では、TOWA-SRDを開発の拠点として、これらの需要の取り込みを図っていきます。

新たな事業展開は、TOWAグループで新たな開発チームとして機能させ、開発を加速させること。

中国市場において、マーケットインの装置開発に取り組むこと。

中国の事業活動における4つの柱

中国の半導体製造装置市場は再び最大となっているため、現地密着型での潜在ニーズに対応すること。

お客様の製品開発から参画し、TOWAのモールドプロセスをお届けすること。



東和半導体設備研究開発(蘇州)有限公司が入っているビル

会社概要

東和半導体設備研究開発(蘇州)有限公司(TOWA-SRD)
(100%子会社)

設立日: 2021年9月26日
従業員数: 30名(2022年3月末時点)
資本金: 300万ドル(約3億2,800万円)

所在地: 中華人民共和国(江蘇)
自由貿易試験区
蘇州片区蘇州工業園区
東長路88号A2棟5階

生産拠点との連携を強めてニーズに対応

所在地の「蘇州2.5産業園」はTOWA半導体設備(蘇州)有限公司(TOWA蘇州)から車で約13分の距離。この「2.5」は、ものづくりから付加価値がもたらされて生まれた2.5次産業を示しており、当社の事業展開に最適なロケーションといえます。

最新のラボ機能を備え、お客様の開発段階から試作・評価をサポートするなど、より柔軟で質の高いサービスを提供できる体制づくりに努めています。

装置製造を行うTOWA蘇州、金型製造を行う東和南通、販売を行う東和上海の3拠点と合わせて、お客様に中国国内で全てのサービスを提供できるようになりました。今後、各拠点の連携をより深めてお客様へのさらなる高付加価値提供を図ります。



2021年9月16日、蘇州工業園区管理委員会と設立に関する調印式をオンラインで行いました。

Column

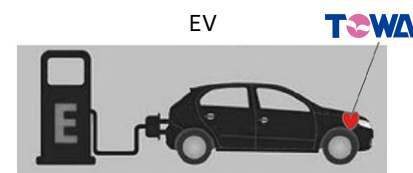
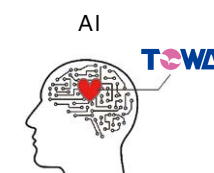
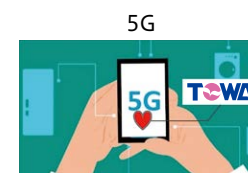
3次元パッケージとTOWA

身近なものから、今後拡大が見込まれる製品など、様々な分野で使用される3次元パッケージに、TOWAの技術が活用されています。

当社は最先端の半導体・エレクトロニクス技術の開発を手掛けるベルギーの国際研究機関imecの研究施設に、2017年にジョイント・デベロップメント・プログラムへの参加を機にコンプレッション装置CPM1080を提供しており、最先端・次世代半導体の製造プロセスやその半導体の実現に貢献しています。

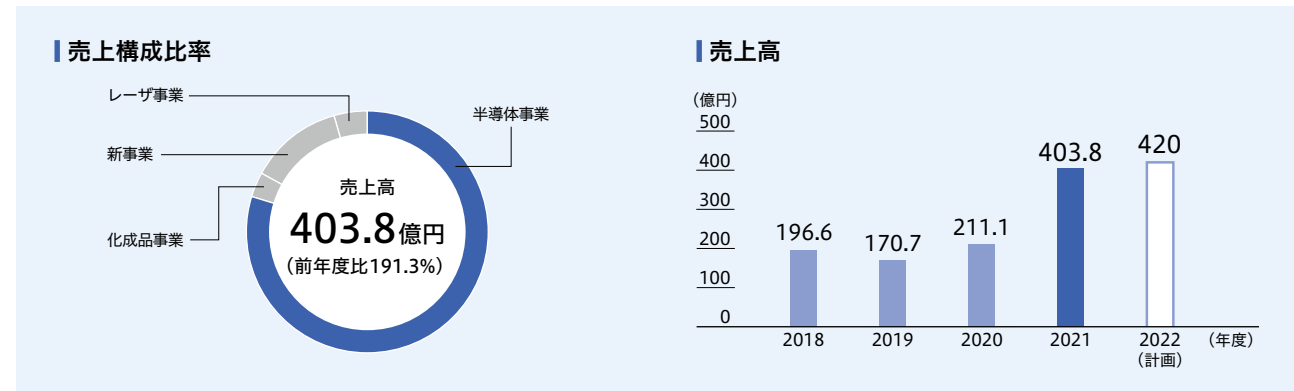


コンプレッション装置 CPM 1080





常に技術革新が求められる半導体分野において、最先端技術を世界に発信し、
モルディング装置のリーディングカンパニーとして進化し続けています。



事業概要

TOWAグループの主力事業で、モルディング装置(樹脂封止装置)、シンギュレーション装置、超精密金型の開発・製造を中心に行っています。

樹脂によって半導体と外部を電氣的に絶縁して封止するモルディング技術は、半導体の信頼性を確保するために不可欠な技術です。

当社では、半導体チップの保護を目的に、熱硬化性樹脂をゲート(供給口)からチップの周囲に供給した後に硬化させる従来型の「トランスファモルディング装置」および、顆粒等の形態で供給された熱硬化性樹脂を金型上であらかじめ加熱溶融させて半導体チップを浸した後にその樹脂を硬化させる当社独自の「コンプレッションモルディング装置」の2方式の装置を製造しています。

コンプレッションモルディング装置は、メモリや5G向けの最先端製品の半導体封止に対応しており、まさに今後のニーズに応えられる製品です。

モルディングされた製品を個片化するシンギュレーション装置では、製品を切断し収納する装置を自社開発しています。

樹脂を成形するための超精密金型は、創業時に当社が開発したモジュールシステムから進化してきたもので、数々の超精密金型を市場に供給しお客様から高い評価を得ています。



2021年度の経営状況

半導体製造装置事業における経営成績は、半導体内製化を推し進める中国地域でモルディング装置・金型及びシンギュレーション装置の売上が大幅に増加したこと、また、高速通信規格(5G)関連製品や車載向けを中心に台湾やその他アジアでも売上が大きく伸長した結果、売上高403億84百万円(前連結会計年度比192億74百万円、91.3%増)となりました。

半導体装置事業の強み

当社は、世界に先駆けてマルチプランジャでの全自動半導体樹脂封止装置を開発し、それを業界標準へと導きました。以来、他社の追随を許さないポジショニングで半導体モルディング市場におけるリーディングカンパニーであり続けています。また、内製にこだわっており、お客様のあらゆるご要望に応える体制を整えています。

先端半導体(後工程)プロセス技術である3Dパッケージング技術には当社独自のコンプレッション技術が最適であり、すでに、台湾のラボ等で開発・評価を行っています。国内での内製化のために製造装置の需要が高まっている中国では、昨年、東和半導体設備研究開発(蘇州)有限公司(TOWA-SRD)を開設し、活動を本格化しています。

最先端ニーズからお客様に近い場所での開発・供給効率化まで、幅広い開発・生産体制でご要望にお応えします。

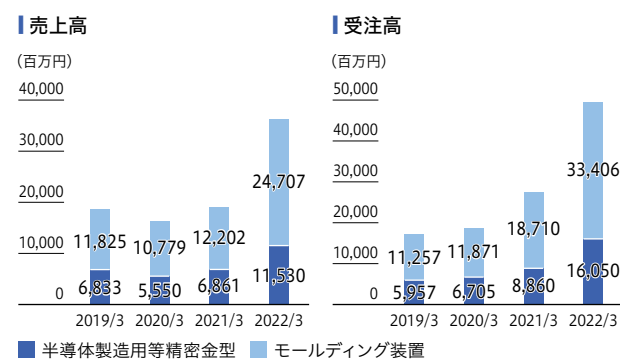
事業戦略

半導体事業における主軸戦略

- 付加価値を活かしたプロセスビジネスの展開により半導体事業の収益力を強化します。
- リードタイム短縮および在庫削減を目的とするMIP (Minimal Inventory & Period)により生産体制・財務基盤の強化を図ります。
- 開発リソースへの積極的な資源投入により顧客ニーズの先取りやSDGs・ESG投資に適った製品の開発をスピード感を持って実行します。
- シンギュレーションとブレードの連携により市場獲得を目指します。



半導体市場の継続的な拡大に加え、世界的な半導体不足や中国での半導体内製化等により高水準で受注が推移。



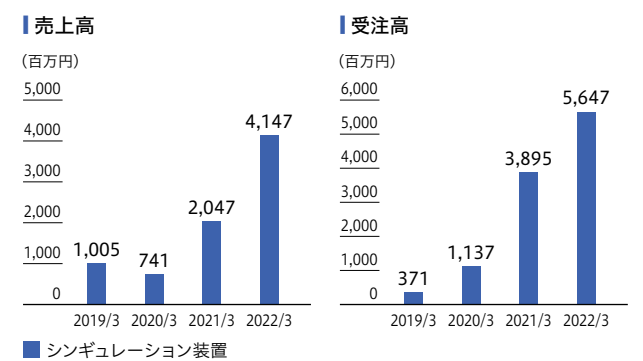
MIPプロジェクト

(Minimal Inventory & Period)

- ▶ リードタイム短縮
- ▶ 在庫適正化(生産方式見直し)
- ▶ 先行生産 ⇄ 受注後生産の切替

シンギュレーション装置

競合他社の納期・サービスを上回る対応によりシェアを拡大。子会社化したブレード事業会社との連携でも市場獲得を目指す。



Topics

15年ぶりに「SEMICON Japan 2021 Hybrid」に出展

当社は、2021年12月15日～17日にかけて東京ビッグサイトで開催された「SEMICON Japan※ 2021 Hybrid」に出展し、半導体業界が活況を呈する国内市場にTOWAの技術を発信しました。同展示会には15年ぶりの出展となります。

当社ブースでは市場を牽引する車載、モバイル、IoT / AI向けの半導体を対象としたモルディング・シンギュレーション技術を中心に、ラボラトリー活動やTSS(トータルソリューションサービス)の取り組み、ものづくりサポート体制などの展示も行いました。

ブースへの総来訪者数は243名と、コロナ禍にも関わらず多くの方々に当社の技術について関心を示していただきました。この出展を通じて得られたつながりを、今後さらなる受注に展開していけるよう、積極的なフォローに努めます。

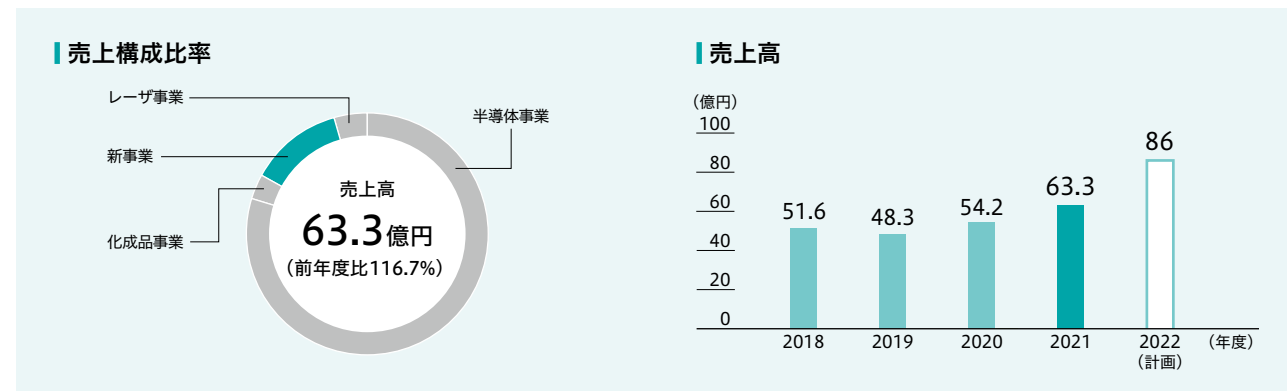
※半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、車やIoT機器などのSMARTアプリケーションまでをカバーする、エレクトロニクス製造サプライチェーンの展示会。



TOWAブース

新事業

コア技術を活かし、新たな市場の創造と事業化にチャレンジしています。



事業概要

- 半導体分野で培ってきた金型製造技術を活用して新事業を展開し、市場における新たな価値創造を目指しています。
- TSS事業（トータルソリューションサービス）**…当社半導体製造装置のアフターサービスや改造・修理、中古機の販売までトータルな提案を行っています。
- 工具事業**…金型製造メーカーのノウハウが蓄積された自社開発の工具を販売しています。
- 受託事業**…TOWAオリジナルの金型表面処理技術に応用したコーティングや、超精密金型で培った超精密・微細加工技術、EF（超精密電鍍）加工技術を医療や光学部品、家庭用品などに応用・複合させた受託加工事業を展開しています。

2021年度の経営状況

新事業における経営成績は、半導体製造装置の納入台数増加にともない、部品販売やアフターサービス機会が拡大したことなどから、TSS事業の売上が増加しました。また、超精密金型製造で培った技術に応用した受託事業や、自社製工具の需要が増加した結果、売上高は63億31百万円（前連結会計年度比9億5百万円、16.7%増）となりました。

事業戦略

新事業における主軸戦略

- コア技術の応用展開により新たな柱となる事業を独立させポートフォリオの変革を図ります。
- TOWAオリジナル商品の創出により新たな事業化を実現します。
- TSS事業を通じてお客様の安定稼働に貢献し、長期的関係を確保します。
- グローバル生産拠点を活用した原価低減により競争力強化とシェア拡大を図ります。

新事業の強み

半導体装置の製造技術・ノウハウ・専門能力を持った人材という独自のリソースを有することが市場において大きな強みとなっています。コーティング、ナノテク、ソーリングなどの技術においては、多様な分野で利用されうするため、今後も幅広い領域での戦略が望めます。また、それを可能にする環境や設備を自社で開発し、整備しています。

京都東事業所の敷地内にて昨年度竣工した新工場において、切削工具の生産能力の増強を行いました。切削工具や受託加工ビジネスの需要拡大に対応するとともに、様々な分野のお客様の課題解決を図ります。



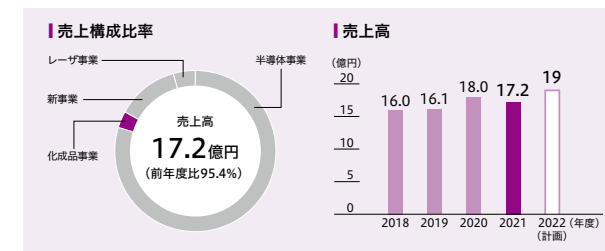
ナノレベルの加工を支える設備と環境も強みの一つ（超微細加工設備）



金型製造メーカーのノウハウが蓄積された自社開発の工具（超硬エンドミルシリーズ）

化成品事業

医療を中心に、さまざまな産業分野で利用されるファインプラスチックで未来に貢献します。



事業概要

化成品事業では、医療、情報通信、情報家電、光学などの分野で活用されているファインプラスチックの成形を行っています。医療機器部品の射出成形および組み立てが主力となっており、1983年に化成品部門の専門化を図るべく設立したグループ会社の株式会社バンディックで製造しています。全ての成形・組立をクリーンルームで行っており、安定して高品質な成形を実現しております。

2021年度の経営状況

化成品事業における経営成績は、事業拡大を目指した新規顧客の獲得は順調に進んだものの、コロナ禍において手術件数が減り一部の医療機器売上が減少し、売上高17億23百万円（前連結会計年度比83百万円、4.6%減）となりました。

事業戦略

化成品事業における主軸戦略

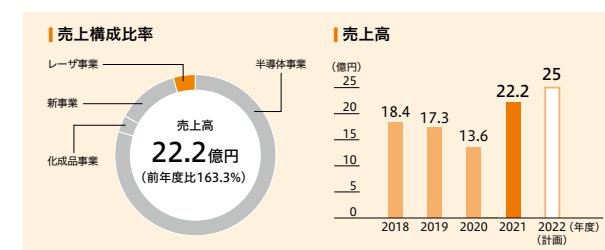
- 化成品事業で培ったコア技術をもとにTOWAブランドの付加価値を高め事業規模を拡大します。
- 品質・コスト・納期を更に追求し安定した収益体質を構築します。
- 医療機器のライセンスを活かし商品の多様化を図ります。



電動射出成形機を40台以上所有し、全てクリーンルームで成形

レーザー事業

レーザー関連技術と半導体製造の後工程技術を融合し、新たな市場を目指します。



事業概要

グループ会社であるTOWAレーザーフロント株式会社にてレーザートリマ、ウェハマーカ、レーザー溶接機を製造しております。今後、レーザー関連技術と半導体製造を融合させ、新たな市場を目指してまいります。

半導体ウェハに品名、ロット番号等の管理番号をレーザーマーキングするウェハマーカ



2021年度の経営状況

レーザー事業における経営成績は、自動車や産業機械向けなど幅広い用途での電子部品の需要回復を背景に、レーザートリマの売上が増加した結果、売上高22億27百万円（前連結会計年度比8億63百万円、63.3%増）となりました。

事業戦略

レーザー事業における主軸戦略

- アプリケーション強化により新商品を創出し、「価値創造」と「価値獲得」を図ります。
- TOWAグループの生産・販売拠点を活用し生産能力アップ・原価低減と販売体制・サービスの強化を図ります。
- 顧客プロセスを徹底追求し、課題解決型ビジネスができる企業へ成長します。

04

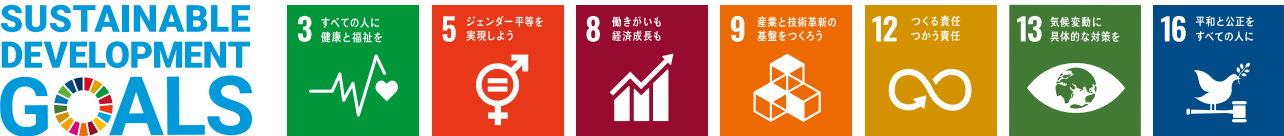
TOWA グループのサステナビリティ方針

サステナビリティ基本方針

私たちTOWAグループは、経営理念、行動基準、環境方針等に基づき、「クォーター・リード」の精神で産業の発展に多大な貢献を果たすとともに、お客様、株主・投資家、取引先、従業員とその家族、地域社会など、全てのステークホルダーとの強固な信頼関係を構築し、企業価値の向上と持続可能な社会の実現を目指します。

TOWAが注力するSDGs

当社は、国連が定める「持続可能な開発目標（SDGs）」における17のゴールのうち、特に事業との関連性が高い以下の項目について、重点的に貢献してまいります。



TOWAの重点課題	活動内容	具体的な事例	関連するSDGs項目	ESGとの関連
独自技術 製品の開発・ 製造・販売	樹脂効率の良い装置の開発	創業後まもなく樹脂の使用効率を高めるマルチプランジャー方式を開発、樹脂の廃棄量を大幅に削減。2009年には樹脂効率100%（廃棄量ゼロ）を達成する独自のコンプレッション方式を開発しました。	8 働きがいも経済成長も 9 産業と技術革新の基盤をつくろう 12 つくる責任つかう責任 13 気候変動に具体的な対策を	E 環境 S 社会
	ゼロディフェクトへの取り組み	次工程に不良品を流出しない、不良品をつくらない、未だ見ぬ不良を見つける、のステップで不良をゼロにする製品の開発に取り組んでいます。		
人材 マネジメント	人材育成	自己啓発・資格取得・各種表彰制度 ● 全社員を対象に毎年2回の通信教育受講を奨励、費用補助などで自己啓発活動を支援しています。 ● 社員へのTOEIC IPテスト受験を奨励し、取得スコアに応じ表彰も実施しています。 ● 勤続や貢献に応じた表彰ほか、「チャレンジ賞」「グローバルTOWA賞」を設けています。	4 質の高い教育をみんなに 5 ジェンダー平等を実現しよう 8 働きがいも経済成長も 9 産業と技術革新の基盤をつくろう	S 社会
	働き方	● 「TOWA働き方改革ポリシー」を策定（2020.4.1）、社員一人ひとりの健康と働きがいを第一に考え、働き方改革を重要な経営課題の1つとしました。 ● 産休・育休後の職場復帰支援を推進しています。 ● ワークライフバランスの醸成を支援。有給休暇取得を奨励する「クリエイティブ・ホリデー」制度の運用を推進しています。		

TOWAの重点課題	活動内容	具体的な事例	関連するSDGs項目	ESGとの関連
人材 マネジメント	健康経営	● 「健(すこやか)漲(みなぎ)りて業(なりわい)壮(さかん)なり」をモットーとする「TOWA健康宣言」を策定して社員の健康維持・増進に取り組んでいます。 ● 社員間コミュニケーションの促進、健康・教養・趣味の向上、心身の錬磨を目的にTOWAクラブ活動・各種会社行事を行っています。 ● 2015.12.1から従業員50名以上の全事業場に対してストレスチェックを実施しています。	3 すべての人に健康と福祉を 8 働きがいも経済成長も	S 社会
健康・環境 への貢献	中古機販売事業	TOWATEC(株)では使用済み半導体製造装置の買取り・再生・販売・サポートを一貫実施。お客様のニーズと資源の有効活用に寄与しています。	8 働きがいも経済成長も 9 産業と技術革新の基盤をつくろう 12 つくる責任つかう責任 13 気候変動に具体的な対策を	E 環境 S 社会
	人々の健康への貢献	● (株)バンディックでは医療機器用プラスチック成形品や、厚労省の許可を受けた高度管理医療機器を製造しています。 ● 阪神タイガース現監督の矢野燿大氏による「39矢野基金」活動に賛同し、筋ジス患者や児童施設への支援を行っています。 ● 社員等を対象とした献血事業への協力を行っています。	3 すべての人に健康と福祉を 8 働きがいも経済成長も 9 産業と技術革新の基盤をつくろう 17 持続可能な消費生活	
	地球環境保全への取り組み	● 電気や紙など資源の使用量をモニタリングし、資源の使用量削減を図っています。 ● 「グリーン調達ガイドライン」「グリーン設計規定」を定め、資材調達および設計・製造の両面で環境保全に取り組んでいます。 ● 「化学物質管理規定」を定め、「安全データシート」に基づき、当社製品に使用される化学物質の管理を厳格に行っています。 ● 国内の半導体製造装置事業で使用する全ての電力を、再生可能エネルギー由来の電力に切り替え、CO2排出量削減に取り組んでいます。 ● 2019年度から社内集約出荷を行い、燃料消費量の削減、排気ガス排出量の低減、ドライバーの労働環境改善を図っています。	7 エネルギーをクリーンに 12 つくる責任つかう責任 13 気候変動に具体的な対策を 15 陸の豊かさを保ち増進	
国際社会の 一員としての 責任の遂行	コンプライアンス	● コンプライアンス教育、輸出管理教育、ハラスメント研修、環境教育ほか社内教育を実施しています。 ● 専用メールアドレス(女性社員専用あり)を設けて内部通報制度を整え、調査委員会が調査を行います。 ● 昨年新たに策定した「人権方針」「腐敗防止方針」に基づき、適切な事業活動に努めてまいります。	5 ジェンダー平等を実現しよう 8 働きがいも経済成長も 10 人権の尊重を促す 16 公平な裁判と公的機関	G ガバナンス
	コーポレートガバナンス	コーポレートガバナンス・コードに沿った経営を実践し、他社の状況や議決権行使助言会社の方針等を踏まえて、より実効的なガバナンス体制を模索しています。	8 働きがいも経済成長も 16 公平な裁判と公的機関	
	リスクマネジメント	社内リスク管理の最高機関として、社長を議長とする「リスク管理委員会」を設け、定期的に対処すべきリスク抽出や評価を実施しています。	8 働きがいも経済成長も 12 つくる責任つかう責任 16 公平な裁判と公的機関	

TOWAグループの環境への取り組み

基本的な考え方

TOWAグループは、持続可能な循環型社会を実現するために、各事業所において環境マネジメントシステムを構築し、グループの事業活動に起因する環境負荷の低減に努めています。

製品開発においても、環境負荷の低減に配慮した設計・開発をテーマに、製品の環境性能向上に努めております。

環境方針

TOWA株式会社は、「地球環境の保全」が人類共通の重要課題であると認識し、事業活動を通じて、環境に配慮した「技術開発」により、「新製品・新商品・サービス」を市場へ供給し、地球環境負荷軽減に貢献します。

- 1.当社は、事業活動および製品やサービスが地球環境に与える影響やその要因を把握し、地球環境汚染の予防、地球温暖化対策に努めます。
- 2.当社は、事業活動および製品やサービスに関わる環境関連の諸法令・規制を順守します。
- 3.当社は、事業活動および製品やサービスにおいて、次の事項を重点テーマとして取り組みます。
 - (1) ライフサイクルを考慮した、環境負荷の少ないグリーン設計の推進
 - (2) サプライチェーンへの働きかけによる、環境負荷の少ないグリーン調達
 - (3) 環境負荷化学物質の厳格な管理
 - (4) 事業活動における省エネ・省資源への取り組み継続
- 4.当社は、「環境方針」を達成するために、戦略目標を定め、具体的に実現するための手段を策定し、その成果を定量的に測定する指標を定め、継続的改善に取り組みます。

2017年4月1日

TOWA株式会社 代表取締役社長 岡田博和

TCFDに基づく情報開示への取り組み

当社グループは「気候変動」を重要な経営課題の一つとして認識し、2022年5月にTCFD※の提言に賛同を表明しました。提言内容に沿って、気候変動関連リスクおよび機会に関するガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の項目について開示しています。環境経営の推進体制を整え、取締役会で気候変動に関する基本方針等を審議・決定しており、2022年度は、気候変動が当社に与えるリスク・機会、それを踏まえたシナリオ分析の内容について審議を行いました。

2021年度は、将来の気候変動が当社事業へもたらすリスク・機会を整理し、1.5℃シナリオを含むシナリオ分析を定性的・定量的に実施することにより当該リスク・機会の影響を評価しました。評価対象は半導体関連製品を含むサプライチェーン全体です。TCFD提言に基づいて当社事業との関係性が高いと想定される主要なリスク項目を洗い出し、影響を整理しました。シナリオ分析については、今後の環境の変化を踏まえ、定期的にレビューしていきます。

※「気候変動関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」の略称。TCFD提言は企業等に対し、気候変動関連情報の開示を推奨している。



移行リスクについては、これまで当社が進めてきた使用電力の再エネ転換が奏功し、炭素価格が上昇した場合でも、コスト増加の影響は限定的であると見積もっております。また自然災害による物理リスクについても、現行シナリオでの損害を試算したところ、こちらも影響は限定的であると見積もっております。

リスク管理については、社長を議長とする「リスク管理委員会」を設け、定期的に対処すべきリスクの抽出や評価を実施しています。

指標と目標については、環境目標の中で「CO₂排出量の削減」を目標として設定し、CO₂排出量の削減に取り組んでおり、その中でScope1、2に関するCO₂排出量の測定・開示を行い、活動実績を公表してまいります。

設定したシナリオの概要

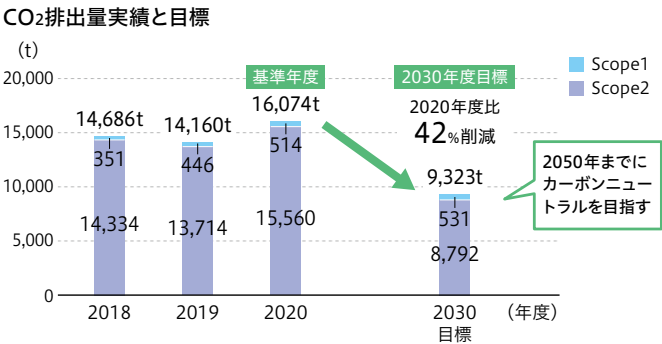
	設定シナリオ	
	1.5℃シナリオ	現行シナリオ(現状維持シナリオ)
想定される事業環境	リスク ● 1.5℃の世界の実現に向け、全世界で炭素税の導入が進み、2030年で先進国では130\$/t-CO₂を超える水準に。 ● 顧客の環境意識が高まり、製造装置の省エネ・省CO₂化が厳格に求められるようになる。ただし、省エネ技術開発は大きく進展する。 機会 ● EV販売台数の伸長や再エネ機器の普及、また顧客の国際イニシアティブ(RE100、SBT等)の達成ニーズの高まりに伴い、半導体製造装置の需要は現状よりも大きく拡大。 ● 経済性に加え、サーキュラーエコノミーの概念の普及に伴い製造装置の中古市場は現状よりも大きく拡大。	リスク ● 台風被害の増加、洪水頻度の増加等激甚災害の頻度増加に伴い、自社工場・サプライチェーン拠点の被災リスクが高まる。 機会 ● EV販売台数の伸長や再エネ機器の普及、また顧客の国際イニシアティブ(RE100、SBT等)の達成ニーズの高まりに伴い、半導体製造装置の需要は拡大傾向も1.5℃シナリオに比べると伸びは緩やかとなる。 ● 経済性の観点から製造装置の中古市場は拡大傾向も1.5℃シナリオに比べると伸びは緩やかとなる。
参照シナリオ	● IEA:WEO2021 NZEおよびSDS ● IPCC 第6次評価報告書 第1作業部会報告書:SSP1-1.9, SSP1-2.6	● IEA:WEO2021 STEPS ● IPCC 第6次評価報告書 第1作業部会報告書:SSP3-7.0, SSP5-8

CO₂排出量の削減目標について―脱炭素の取り組み

2030年度のScope1+2のCO₂排出量を2020年度比42%削減し、2050年までに実質ゼロ(カーボンニュートラル)を目指します

当社グループでは、TCFDの情報開示における「指標と目標」でも表明したように、CO₂排出量の削減目標を設定しています。2030年度の削減目標については、売り上げの大きな成長計画を盛り込んだうえで総量削減に取り組みます。

2021年度は、自社で消費する燃料や電力(Scope1、2)の再生エネルギーへの転換を大きく図る取り組みに着手しました。2022年度にかけて、順次、CO₂削減の効果が現れます。2021年7月にはTOWA本体の国内生産拠点全てで使用する電力を電力会社の再生可能エネルギープランに切り替えました。2022年3月には本社・工場のガス空調機器の電力化も行い、2022年度はTOWA本体で使用するエネルギー(Scope1、2)について2020年度比で99%近いCO₂排出量が削減できる見込みです。



E
環境

TOWAグループの環境への取り組み

活動内容・取り組み例

京都東事業所の新工場、蘇州工場、マレーシア工場で
太陽光パネルを導入、さらなる創エネ推進へ

TOWAグループでは、再生可能エネルギーの活用を積極的に推進しています。2021年7月から国内の主要事業所(本社・工場、京都東事業所、九州事業所)で使用する電力を全て再生可能エネルギーに切り替えており、太陽光パネルも導入を進めています。

2022年3月に完成した京都東事業所の新棟に設置した太陽光パネルは、7月に既存棟に設置されるパネルと合わせ、京都東事業所で使用する電力の約9%をまかなうことができます。これは年間約280トンの二酸化炭素削減に相当します。

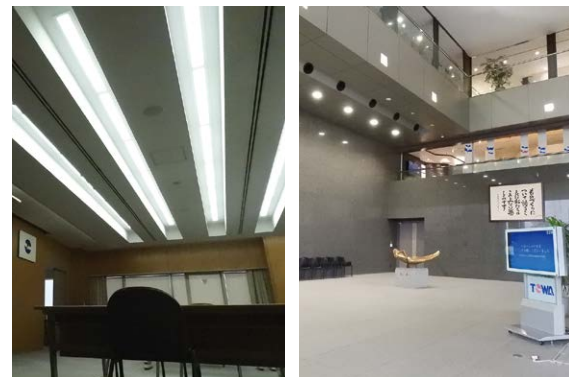
中国蘇州工場、マレーシア工場でも2022年1月に太陽光パネルの設置が完了しています。これにより、蘇州工場では年間約1,020トン、マレーシア工場では年間約1,330トンの二酸化炭素を削減できる見込みです。いずれの工場も年間約30%の排出量削減となります。今後も、自社内でのさらなる創エネ推進に努めます。



京都東事業所では新棟に太陽光パネルを設置



蘇州工場の太陽光パネル



電灯のLED化は、順次未対応部分にも着手

本社・工場で電灯LED化を推進、
年間約13tのCO₂削減

2015年と2016年に行った工場、執務室電灯のLED切り替えに続き、2022年1月より順次、未対応部分のうち1,000カ所余りをLEDに切り替えました。これにより、年間約13トンの二酸化炭素削減に相当する効果が得られます(排出係数0.350kg-CO₂/kWhにて算出)。

本社・工場で消費する電力は昨年度に再生可能エネルギープランに切り替え済みですが、消費電力総量の削減に継続して取り組みます。

電気自動車導入

2022年3月、脱炭素の取り組みの一環として、本社・工場に社用車として電気自動車1台を導入しました。本社・工場では昨年度に電力を再生可能エネルギーに転換していることから、社内で充電を行った場合、走行時のCO₂排出はゼロとなります。2020年度の当社社用車の運用実績データをもとにした試算では、ガソリン車を電気自動車に置き換えた場合、走行時のCO₂排出量として年間最大1,450kg/台の削減につながります。

これからも、電気自動車の運用を継続・拡大してまいります。

社内の充電により走行時CO₂排出量はゼロに集約出荷で、CO₂・コスト・廃棄物の削減を実現

当社では2019年度から海外グループ会社への製品出荷を極力集約して行っています。これにより輸送件数の削減が可能となり、生産高が増加しても輸送費等の間接費は減少しました。集約出荷はコストダウンだけでなく、CO₂排出量の削減につながります。2021年度は月平均で約8%、出荷依頼件数に対する実際の出荷件数を削減しました。加えて、出荷の回数減に伴うトラック等の燃料消費量の削減、排気ガス排出量の低減、ドライバーの労働環境改善にも貢献しています。

また、梱包方法もこれまでの木枠からトライウォール(三層強化段ボール)への変更を推奨し、廃材の減少に取り組んでいます。

ウォームビズ・クールビズの実施

地球温暖化対策への取り組みの一環として、本社・工場、京都東事業所、九州事業所でウォームビズ・クールビズを導入し、国内外グループ会社にて、各地域事情を考慮した省エネ運動を展開しています。社内で「身だしなみに関する決定事項」を設け、クールビズにおいては上着なし可、ノーネクタイ可など、ウォームビズにおいてはカーディガンなどの着用や重ね着を可とするなど、エアコンに頼らない着衣による温度調節を促すことによって節電に努めています。



クールビズ実施中の横断幕で社内の意識付け

グリーン調達・グリーン設計・グリーン購入への取り組み

当社は環境マネジメントシステム(EMS)認証の一環として、「グリーン調達ガイドライン」および「グリーン設計規定」を定め、資材調達および設計・製造の両面においてRoHS指令規制物質への対応や環境負荷物質の低減に取り組んでいます。また、製品に関わるサプライヤーや環境側面に大きく関わる業務委託先等には重要度ランクに応じて当社の環境方針、各種手順書、グリーン調達ガイドラインを配布して遵守をお願いし、サプライチェーンを通じての環境保全に取り組んでいます。

これからも環境に配慮した当社製品の設計・開発に努めてまいります。

TOWA グリーン調達ガイドライン 第6版(2020年4月16日発行)[抜粋・要約]

1. グリーン調達の目的

お取引先様からの資材・役務等購入に際して「依頼事項」遵守を選定条件とし、RoHS規制10物質などの有害化学物質が含まれない材料・部品・完成品の調達を優先します。

2. 対象と依頼事項

対象:当社から発注し、メーカー・商社・協力工場様より納入いただく素材、購入品、消耗品、加工品、役務
依頼事項:有害化学物質を含有していないこと(RoHS対応品)、代替品がなく有害化学物質を含有する場合、当社購買部門への事前情報の提出(新規納入時)、梱包材の最少化・再利用化・材質表示、化学性の薬品・潤滑油・洗浄液など「SDS」の提出 など

3. 有害化学物質の種類と閾値

鉛/鉛化合物や六価クロム/六価クロム化合物、ポリ臭化ビフェニル(PBB類)、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)など、10種類の有害化学物質を指定し、それぞれに閾値を設定。有害化学物質の「不使用証明書」の提出をお願いする場合があります。

4. サプライチェーン先の化学物質管理について

購入先様において取引されているサプライチェーン全般における指定化学物質の含有状況を把握し、当社への納入物品に当該化学物質が含有することの無きよう、適切な維持管理をお願いいたします。

環境負荷化学物質の管理体制

当社は「化学物質管理規定」を定め、「安全データシート(SDS)」に基づき、事業活動や当社製品に使用される化学物質の管理を厳格に行っています。

TOWA グループの社会への取り組み

基本的な考え方

ものづくりや製品開発における品質向上や安全安心だけでなく、全ての従業員とその家族の健康と幸せを追求するため、多様な個性を尊重した働き方を推進します。また、SDGsの考え方にに基づき、地域の安全や健康増進、活性化のために社会的責任を果たします。

活動内容・取り組み例

ダイバーシティ&インクルージョン

ダイバーシティ企業への成長を目指して

当社では、年齢・国籍・性別・障がいの有無などの「属性」のダイバーシティに加え、目に見えにくい価値観・経験などで生まれる「視点・思考」を含めたダイバーシティを尊重し、それらを「強み」に変えるグループ全体での仕組みや風土づくりを進めています。

2022年3月16日、定年以降も定年前と同水準の給与で処遇する再雇用制度を創設しました。3月28日には障がい者雇用の拡大に向けて、企業の社会的責任を果たすだけでなく障がい者との共生に向けて社員の知識・意識の向上を図る目的で社内研修会を開催しました。

多様な人材づくり

多様な価値観の尊重

障がい者雇用の拡大

女性の活躍促進



障がい者雇用の拡大に向けた社内研修

安心・安全な商品をつくり、届ける

信頼と満足のために追求する最高の品質

ものづくりを事業活動の根幹とする当社は、設計、製造、検査および納品後のアフターサービスまで、すべての工程において一貫した品質を保証するプロセスの構築と改善に取り組んでいます。同時に、最新システムやAIの導入などを通してサービスや業務の質の向上を図っています。

また、品質方針を策定し、これを達成するために、戦略目標を定め、具体的な実現手段を策定し、その成果を定量的に測定する指標を定め、継続的改善に取り組んでいます。

世界の半導体装置市場に製品を供給する当社では、早くから品質保証体制の確立に取り組んできました。グローバル化に対応した国際的な技術水準での品質保証活動を展開するため、品質保証の国際規格であるISO9001の認証も取得しています。昨年11月には更新審査を受審し登録更新の承認を得ました。



最新技術と高品質の製品を生み出す設備と環境

ISO9001認証
(品質)ISO14001認証
(環境)

(坂東記念研究所、INNOMS推進室を除く)

社会貢献活動

交通安全活動

交通安全活動として当社では、全日本交通安全協会などが実施する「交通安全年間スローガン」募集に参加しています。また、優良運転者・事業所普及を目的として京都府交通安全協会が実施している事故防止コンクール(セーフティラリー)事業にも参加しています。これは期間中の無事故・無違反を目指すというもので、全社あげて参加しています。今年4月、優良安全運転管理事業所として京都府交通安全協会より表彰をいただきました。

優良安全運転管理事業所 表彰状



社内献血の実施

毎年春季と夏季の2回、社員等を対象とした献血事業への協力を行っています。当社の長年にわたる献血事業への理解と協力に対し、日本赤十字社から、「銀色有功章」と「金色有功章」を授与されました。これからも輸血を必要とする世界中の人々を支えていくために、日本赤十字社と協力し、積極的に献血活動の普及、啓発に取り組んでまいります。

日本赤十字社の「金色有功章」



39矢野基金への協力

当社は、阪神タイガース現監督の矢野燿大氏による「39(サンキュー)矢野基金」活動に賛同し、売上の一部が筋ジストロフィー症患者の方や児童養護施設の子供たちへの支援金となる「応援自動販売機」を設置しています。2015年に設置した「応援自動販売機」は京都での設置第一号となりました。

本社・工場に設置の応援自動販売機



京都ハンナリーズ(B.LEAGUE)への協賛

当社は、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチームで京都市をホームタウンとする京都ハンナリーズのチームパートナー(シルバーパートナー)として、同チームを支援しています。社会貢献の一環としてチームと地元・京都を盛り上げてまいります。



京都ハンナリーズロゴ



S

社会

TOWA グループの社会への取り組み

スマートな働き方の推進

「TOWA 働き方改革ポリシー」の策定

社員の価値観やライフスタイルを尊重しサポートすることを目的に、2020年4月1日、「TOWA 働き方改革ポリシー」を策定しました。当社は、「社員＝財産」と捉えることから、社員一人ひとりの健康と働きがいとを第一に考え、働き方改革を重要な経営課題のひとつとしてとらえています。社員の主体性を大切にしたい同ポリシーは、個々の社員が自身および周囲の働き方を考えることで、就業環境の整備や自己成長のチャンスを掴もうとする「自ら変えていく力」を応援しています。

ライフスタイルに応じて活用できる、産休・育休後の職場復帰支援制度

社員が出産や育児をしながらいきいきと仕事を続けていけることが社員の健康、働きがいにつながるものであるととらえる、ライフスタイルに応じて柔軟に活用できる制度づくりと理解ある職場の環境づくりを心掛けています。

今後もより多くの社員が安心して産休・育休を取得でき、会社に復帰した際に社員が働きやすいと感じる温かい環境づくりを推進してまいります。

仕事との両立サポート

育児休業	介護休業
看護	復職

など

健康経営の推進

■TOWA 健康宣言

「健(すこやか)漲(みなぎ)りて業(なりわい)壮(さかん)なり」を掲げる健康宣言を策定し、社員全員の健康維持・増進に取り組んでいます。笑顔あふれる職場づくりで社員・家族の健康を目指します。



■ストレスチェックの実施

メンタルヘルス不調を未然に防ぐため、e-ラーニングを活用してメンタルヘルス教育を行うとともに、労働安全衛生法に定めるストレスチェックを実施しています。

■健康経営推進委員会の開催

安全衛生委員会では、3カ月に1回「健康経営推進委員会」を開催して社員の身体と心のケアに努めています。

■生活習慣病予防検診の実施

40歳以上の正社員・嘱託社員のうち希望者の定期健康診断に、生活習慣病予防健診(半日人間ドック)を実施しています。

■TOWA クラブ活動・各種会社行事

社員が立ち上げた運動・文化系のクラブ活動に多くの社員が参加しています。活動費の一部を会社が補助することで、個人の負担を軽減し、活動を支援しています。社員の家族が参加できるイベントも開催しています。

Topics

「健康経営優良法人2022」に認定されました



経済産業省と日本健康会議が実施する健康経営優良法人認定制度において「健康経営優良法人2022(大規模法人部門)」に認定されました。今後も社員の健康維持向上と、安全にいきいきと働くことが出来る職場環境づくりに取り組み、健康経営を推進してまいります。



健康経営への取り組みはこちらからご参照ください。 <https://www.towajapan.co.jp/jp/company/health/>

人材育成・人材開発・幹部やリーダーの育成

人材育成に関する具体的取り組み

■TMP活動

業務改革と人材育成を目的に、チームでワークショップを実施し、さまざまなテーマについて話し合い発表するTMP(TOWA未来プロジェクト)を継続しています。

■改善提案制度

経営への参加意識の高揚、研究開発意欲の鼓舞を目的として、経営および業務全般について、社員の改善創意工夫を募る改善提案制度を設けています。2021年度は目標であった全員参加が達成され、1,800件を超える提案が出されました。

■研修・教育

eラーニングを通じて、コンプライアンス教育、輸出管理教育、ハラスメント研修、メンタルヘルス教育、情報セキュリティ教育、環境教育などの各種教育を実施。

■社内表彰・褒章制度

勤続年数に応じた勤続表彰や、業績への貢献などに応じた表彰があります。挑戦を称える「チャレンジ賞」、世界の関係会社に授与する「グローバルTOWA賞」も。

人権の尊重

人権方針の策定 2022年2月28日、「人権方針」および「腐敗防止方針」を策定しました。

TOWAグループは、自らの事業活動において、影響を受けるすべての人々の人権が尊重されなければならないことについて理解を深め、本方針に基づき、適切に活動して参ります。

■適用範囲

本方針は、TOWAグループの全役職員(役員・正社員・契約社員を含む、すべての社員)に対し適用されます。ビジネスパートナーに対して、本方針の支持を期待し、サプライヤーに対しては支持および遵守を期待します。

■人権尊重の実践

私たちは、「国際人権章典」及び国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」に規定された人権を尊重していくことをお約束するとともに、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」を支持し、実践に向け取り組みます。

人種、民族、国籍、社会的身分、門地、性別、障がいの有無、健康状態、思想・信条、性的指向・性自認及び職種や雇用形態の違い等に基づくあらゆる差別の禁止、ハラスメントの禁止、安全な労働環境の提供、最低賃金の確保、適正な労働時間管理を含む責任ある労働慣行、結社の自由と団体交渉権の尊重を実践します。人身取引を含む、いかなる形態の奴隷労働、強制労働および児童労働も認めません。

また、事業活動において各国の法規制を遵守します。万が一、当該国の法令との国際的な人権方針が異なる場合は、より高い基準に従い、相反する場合は、国際的に認められた人権方針を最大限に尊重します。

2022年2月28日

TOWA 株式会社 代表取締役社長 岡田博和



TOWA グループのコーポレートガバナンス

高度なコーポレートガバナンスを実現するために

当社は、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレートガバナンス体制の充実を図っております。

当社は、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの一層の強化と実践に努めております。

1. 当社グループの行動が法と社会倫理に基づいていること
2. 経営の透明性、客観性を確保し維持すること
3. 環境の変化に迅速に対応できる組織・体制を構築すること
4. 株主の権利の保護や平等性の確保など株主重視の公正な経営を徹底していくこと
5. ステークホルダーとの円滑な関係の構築を通じて企業価値や雇用を創造すること

コーポレートガバナンス・システム

当社の主な取り組み内容は以下のとおりです。

取締役会の機能強化について

当社は取締役会の機能強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を図るとともに、迅速な意思決定と業務執行により経営の効率性を高める目的から、2016年6月より監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役3名の計4名(男性2名、女性2名)で構成しており、内部監査室及び会計監査人と緊密に連携をとることで必要な情報の共有化を図っております。

任意の委員会について

取締役の人事および報酬制度における審議プロセスの公正性、透明性および客観性を高め、コーポレートガバナンスの充実を図るため、2021年4月1日付で取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会を発足いたしました。当委員会は、独立社外取締役3名と、代表取締役1名および管理本部担当取締役1名の計5名で構成されており、議長は独立社外取締役が務めております。

指名・報酬委員会

議長	取締役監査等委員(社外)	和氣 大輔
委員	代表取締役社長 取締役上席執行役員(経営企画本部・管理本部担当) 取締役監査等委員(社外) 取締役監査等委員(社外)	岡田 博和 柴原 信隆 後藤 美穂 田中 素子

政策保有株式の縮減について

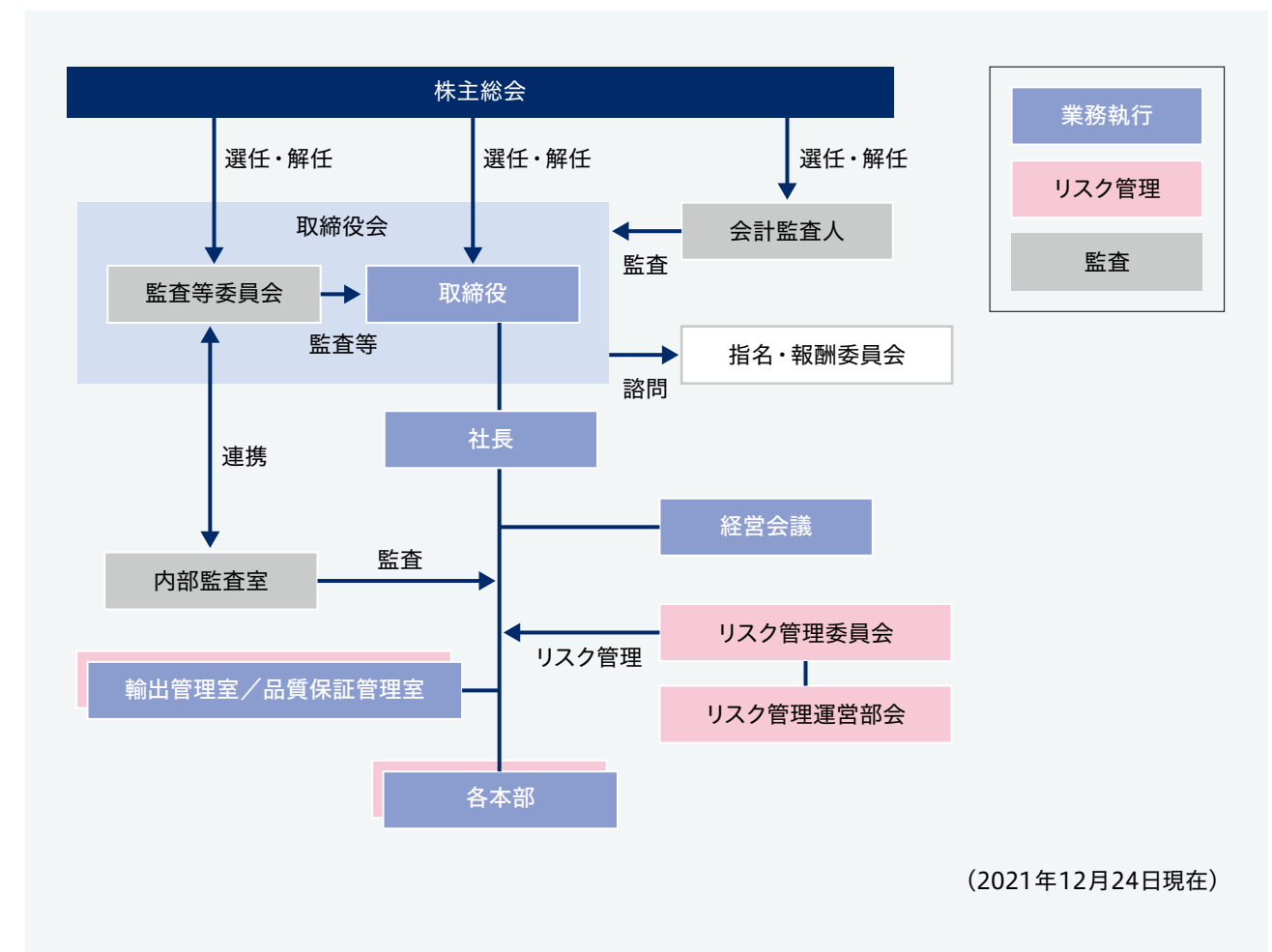
当社は、持続的な成長と中長期的な成長を図るため、業務提携、資金調達、取引拡大など経営戦略の一環として、必要と判断する企業の株式を保有することがあります。保有する株式については、保有目的が適切か、保有にともなう便益やリスクが資本コストに見合っているか等を定期的に検証するとともに、検証結果を踏まえ、取締役会で保有継続の可否等について判断いたします。保有する意義の乏しいと判断される銘柄については、市場動向や考慮すべき事情に配慮しつつ売却を行います。

上記の検証を個別銘柄毎に行い取締役会で検討した結果、2022年3月期は1銘柄を売却いたしました。政策保有株式残高については、2022年3月末の時価で換算すると、2022年3月末連結純資産の9.4%になりました。

その他、詳細につきましては下記コーポレートガバナンスのウェブサイトをご参照ください。

 <https://www.towajapan.co.jp/jp/company/governance/>

コーポレートガバナンス体制図





TOWAグループのコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスの強化に向けた取り組み

新市場区分「プライム市場」上場

当社は、2021年7月9日付で株式会社東京証券取引所より、新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果を受領し、「プライム市場」の上場維持基準に適合しているという結果を得て、新市場区分の選択申請に係る手続きを進めておりました。同取引所が実施した市場区分の見直しにあたり、2022年4月4日より「プライム市場」へ移行いたしました。この移行に伴い、今後もより一層のコーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。



コーポレート・ガバナンス強化への主な実施項目

■政策保有株式の売却

2022年3月期は1銘柄の売却を実施、2022年3月期末における純資産に占める割合は9.4%になりました。

■TCFDなど、気候変動に係るリスク・収益機会等の開示

2022年5月、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）の提言に賛同、情報開示の充実を図ることを表明しました。

■スキルマトリックス作成

取締役会の機能向上のため、取締役の有するスキルを可視化するスキルマトリックスを作成し、活用してまいります。

■コーポレートレポート作成

TOWA 初となるコーポレートレポートを作成し、2022年6月に発行します。

■株式報酬制度導入

第44回定時株主総会で付議。

コンプライアンス

内部通報制度

社員相談窓口として総務部が専用メールアドレスを設けており、社員は直接通報や相談ができる仕組みを整えています。女性社員専用のメールアドレスも設けており、担当の女性社員に直接届くようになっています（電子メール以外の面会等による方法も可能です）。調査委員会が調査を行い、必要に応じて社外の専門家等にも相談いたします。なお、公益通報者が不利益を被らないよう社内規程で定め配慮しています。

社内教育

法令や社会規範を遵守して事業活動および会社生活を営むうえで必要となる知識を、主にeラーニングを通じて社員に徹底しています。階層別で受講するWeb通信教育講座でもCSR・コンプライアンス関連の講座を設けております。定期的の実施することにより社員の知識・意識の定着を図っています。

実施している教育の例

コンプライアンス教育、輸出管理教育、ハラスメント研修、メンタルヘルス教育、情報セキュリティ教育、環境教育

腐敗行為の防止

当社グループは、「腐敗防止方針」に基づき、贈収賄、横領、利益供与の強要、不正入札等の、自己または第三者の職務上の権力や地位の濫用といった腐敗行為、また、それに加担する行為である司法妨害、資金洗浄等の防止の徹底に努めています。

腐敗防止方針

TOWAグループは、贈収賄・腐敗防止の徹底に努めています。

適用範囲

本方針は、TOWAグループの全役職員（役員・正社員・契約社員を含む、すべての社員）に対し適用されます。ビジネスパートナーに対して、本方針の支持を期待し、サプライヤーに対しては支持および遵守を期待します。

腐敗行為の防止

贈収賄、横領、利益供与の強要、不正入札等の自己または第三者の職務上の権力や地位を濫用する行為、また、それに加担する行為である司法妨害、資金洗浄等を行いません。

贈収賄の防止

贈収賄に関して、TOWAグループは公務員や民間取引先を含めた第三者から、直接、間接を問わず、ビジネスの獲得・維持や不適切なビジネス上の優位性確保のために不適切な影響を及ぼすことを目的とした、いかなる形式の金銭・贈答品・接待およびその他便益供与を行いません。また、当社の意思決定に影響を及ぼすおそれのある金銭・贈答品、接待およびその他便益の供与を受けません。

2022年2月25日
TOWA 株式会社
代表取締役社長 岡田 博和

リスクマネジメント

社内のリスク管理の最高機関として、社長を議長とする「リスク管理委員会」を設け、定期的に対処すべきリスクの抽出や評価を実施しています。当委員会の下には複数のリスク管理分科会が設置されており、テーマごとに内部統制、輸出管理、品質保証、災害対策等におけるリスクを毎月ウォッチしています。これらの分科会の活動状況は4半期ごとに取締役会で報告され社外取締役も内容を確認しています。

役員一覧

取締役



代表取締役社長
岡田 博和



取締役常務執行役員
石田 耕一

コア技術事業本部・開発本部・
シンギュレーション開発本部担当



取締役上席執行役員
柴原 信隆

経営企画本部・管理本部担当



取締役執行役員
西村 一洋

生産本部担当



取締役執行役員
三浦 宗男

営業本部担当



取締役常勤監査等委員
蒲生 喜代重



取締役監査等委員(社外)
和氣 大輔

和氣公認会計士事務所所長
シライ電子工業株式会社
社外取締役監査等委員



取締役監査等委員(社外)
後藤 美穂

後藤総合法律事務所弁護士



取締役監査等委員(社外)
田中 素子

田中公認会計士事務所所長

執行役員

上席執行役員 フェロー

早坂 昇

TOWAレーザーフロント株式会社
代表取締役社長

上席執行役員

鈕 方舜

東和半導体設備(上海)有限公司
董事長・総経理

上席執行役員

韓 相倫

TOWA 韓国株式会社 代表理事
TOWA ファイン株式会社 代表理事

執行役員

笹田 秀典

TOWATEC 株式会社 代表取締役社長

執行役員

中西 和彦

経営企画本部長 兼 秘書室長 兼
INNOMS 推進室長

スキルマトリックス

	地位・役職	社外	独立	指名報酬 委員会	企業経営	生産 技術開発	海外駐在 経験	営業マーケ ティング	会計	法務コンプ ライアンス
岡田 博和	代表取締役 社長			○	●	●	●	●		
石田 耕一	取締役常務 執行役員					●		●		
柴原 信隆	取締役 上席執行役員			○	●		●			●
西村 一洋	取締役 執行役員				●	●	●			
三浦 宗男	取締役 執行役員						●	●		
蒲生 喜代重	取締役常勤 監査等委員				●		●			
和氣 大輔	取締役 監査等委員	○	○	◎					●	
後藤 美穂	取締役 監査等委員	○	○	○						●
田中 素子	取締役 監査等委員	○	○	○					●	

◎は委員長

連結貸借対照表

単位：(千円)		
連結貸借対照表	2021年3月期	2022年3月期
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,686,470	12,407,734
受取手形及び売掛金	8,892,523	－
受取手形	－	433,869
電子記録債権	50,752	287,488
売掛金	－	11,109,984
商品及び製品	2,792,537	5,611,677
仕掛品	5,578,889	12,073,269
原材料及び貯蔵品	781,913	887,111
その他	1,175,001	1,410,287
貸倒引当金	△581	△1,824
流動資産合計	29,957,506	44,219,598
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	18,196,280	20,530,183
減価償却累計額	△10,976,114	△11,743,840
建物及び構築物(純額)	7,220,165	8,786,342
機械装置及び運搬具	11,414,556	14,821,934
減価償却累計額	△9,003,589	△10,061,540
機械装置及び運搬具(純額)	2,410,967	4,760,394
土地	4,365,904	5,189,580
リース資産	950,680	1,143,187
減価償却累計額	△194,350	△214,619
リース資産(純額)	756,329	928,567
建設仮勘定	949,770	609,744
その他	3,787,980	4,159,290
減価償却累計額	△3,250,659	△3,407,026
その他(純額)	537,320	752,264
有形固定資産合計	16,240,458	21,026,894
無形固定資産		
その他	636,520	1,306,830
無形固定資産合計	636,520	1,306,830
投資その他の資産		
投資有価証券	3,855,862	3,856,319
繰延税金資産	570,084	261,653
退職給付に係る資産	330,375	397,596
その他	199,709	264,172
投資その他の資産合計	4,956,031	4,779,741
固定資産合計	21,833,009	27,113,466
資産合計	51,790,516	71,333,064

単位：(千円)		
連結貸借対照表	2021年3月期	2022年3月期
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,214,770	5,110,149
電子記録債務	1,725,148	2,888,655
短期借入金	1,500,000	5,300,000
1年内返済予定の長期借入金	1,340,000	1,340,000
リース債務	88,881	131,512
未払法人税等	798,277	2,417,288
前受金	－	4,725,212
賞与引当金	687,433	896,122
役員賞与引当金	46,941	78,943
製品保証引当金	216,097	368,956
その他	4,022,748	2,269,111
流動負債合計	14,640,298	25,525,952
固定負債		
長期借入金	4,610,000	3,270,000
リース債務	266,943	377,495
繰延税金負債	6,860	227,071
退職給付に係る負債	757,838	778,820
その他	4,819	32,398
固定負債合計	5,646,460	4,685,785
負債合計	20,286,759	30,211,738
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,932,627	8,932,627
資本剰余金	462,236	462,236
利益剰余金	19,090,395	26,820,078
自己株式	△11,665	△12,732
株主資本合計	28,473,594	36,202,210
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,195,067	2,261,645
為替換算調整勘定	411,764	2,169,889
退職給付に係る調整累計額	100,747	94,940
その他の包括利益累計額合計	2,707,578	4,526,476
非支配株主持分	322,584	392,639
純資産合計	31,503,757	41,121,326
負債純資産合計	51,790,516	71,333,064

連結損益計算書及び連結包括利益計算書

単位：(千円)		
連結損益計算書	2021年3月期	2022年3月期
売上高	29,706,793	50,666,728
売上原価	20,089,349	32,013,150
売上総利益	9,617,443	18,653,577
販売費及び一般管理費	5,998,496	7,148,443
営業利益	3,618,946	11,505,133
営業外収益		
受取利息	25,388	27,689
受取配当金	35,713	49,858
固定資産賃貸料	19,410	43,849
為替差益	－	34,648
補助金収入	295,252	43,986
奨励金収入	32,823	29,023
雑収入	69,601	96,891
営業外収益合計	478,189	325,948
営業外費用		
支払利息	55,238	52,358
貸与資産減価償却費	12,400	26,402
支払手数料	3,958	17,506
為替差損	195,960	－
雑損失	10,669	10,510
営業外費用合計	278,226	106,778
経常利益	3,818,909	11,724,303
特別利益		
固定資産売却益	13,437	11,136
投資有価証券売却益	853	34,227
特別利益合計	14,290	45,364
特別損失		
固定資産売却損	979	42
固定資産除却損	15,143	26,357
減損損失	－	47,838
投資有価証券売却損	2,408	－
特別損失合計	18,531	74,238
税金等調整前当期純利益	3,814,668	11,695,429
法人税、住民税及び事業税	1,000,650	3,167,658
法人税等調整額	147,950	376,623
法人税等合計	1,148,601	3,544,282
当期純利益	2,666,067	8,151,146
非支配株主に帰属する当期純利益	2,865	21,318
親会社株主に帰属する当期純利益	2,663,201	8,129,827

単位：(千円)		
連結包括利益計算書	2021年3月期	2022年3月期
当期純利益	2,666,067	8,151,146
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	838,448	66,578
為替換算調整勘定	1,020,043	1,806,862
退職給付に係る調整額	160,226	△5,806
その他の包括利益合計	2,018,717	1,867,634
包括利益	4,684,784	10,018,780
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	4,655,850	9,948,725
非支配株主に係る包括利益	28,934	70,055

連結キャッシュ・フロー計算書

単位：(千円)					
連結キャッシュ・フロー計算書	2021年3月期	2022年3月期	連結キャッシュ・フロー計算書	2021年3月期	2022年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー			投資活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	3,814,668	11,695,429	定期預金の預入による支出	△663,959	△1,543,989
減価償却費	1,601,109	1,949,994	定期預金の払戻による収入	472,501	1,837,012
のれん償却額	28,983	14,263	投資有価証券の売却による収入	15,601	141,924
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△998	△15	その他の投資に係る支出	△4,401	△33,231
賞与引当金の増減額(△は減少)	146,199	187,445	有形及び無形固定資産の取得による支出	△2,691,039	△5,272,134
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	15,390	29,805	有形及び無形固定資産の売却による収入	43,011	1,344
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△7,957	△72,162	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,727,490
製品保証引当金の増減額(△は減少)	56,759	149,902	その他	60,003	△3,705
受取利息及び受取配当金	△61,101	△77,548	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,768,283	△6,600,269
支払利息	55,238	52,358	財務活動によるキャッシュ・フロー		
為替差損益(△は益)	108,789	52,120	短期借入金の純増減額(△は減少)	△2,300,000	3,800,000
売上債権の増減額(△は増加)	△678,289	527,869	長期借入れによる収入	1,500,000	－
棚卸資産の増減額(△は増加)	△2,190,014	△8,494,949	長期借入金の返済による支出	△1,136,875	△1,340,000
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△36,658	△59,697	自己株式の取得による支出	△273	△1,067
仕入債務の増減額(△は減少)	3,078,656	1,417,706	配当金の支払額	△400,147	△400,144
その他の流動負債の増減額(△は減少)	225,705	533,783	非支配株主からの払込みによる収入	201,570	－
その他	△298,169	161,140	その他	△104,952	△133,475
小計	5,858,311	8,067,446	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,240,677	1,925,312
利息及び配当金の受取額	60,007	77,914	現金及び現金同等物に係る換算差額	142,099	253,104
利息の支払額	△53,996	△53,027	現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	444,984	1,982,032
法人税等の支払額	△570,329	△1,704,345	現金及び現金同等物の期首残高	9,823,443	10,268,427
法人税等の還付額	17,854	15,895	現金及び現金同等物の期末残高	10,268,427	12,250,459
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,311,846	6,403,884			

会社概要(2022年3月31日現在)

会社情報

商号	TOWA 株式会社 (英文名 TOWA CORPORATION)
設立	1979年4月17日
資本金	8,932,627,777円
本社所在地	京都市南区上鳥羽上調子町5番地 ☎(075)692-0250(代表)
従業員数	573名(単体) 1,817名(連結)
ホームページ	https://www.towajapan.co.jp
上場取引所	東京証券取引所プライム市場

TOWA グループ

国内
TOWA 株式会社 本社・工場 京都東事業所 坂東記念研究所 九州事業所 株式会社バンディック TOWATEC 株式会社 TOWA レーザーフロント株式会社

海外
TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd.(シンガポール) TOWAM Sdn. Bhd.(マレーシア) TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.(フィリピン) TOWA THAI COMPANY LIMITED(タイ) TOWA USA Corporation(米国) TOWA Europe B.V.(オランダ) TOWA Europe GmbH(ドイツ) TOWA 半導体設備(蘇州)有限公司(中国) 東和半導体設備(上海)有限公司(中国) 東和半導体設備(南通)有限公司(中国) 東和半導体設備研究開発(蘇州)有限公司(中国) 台湾東和半導体設備股份有限公司(台湾) TOWA 韓国株式会社(韓国) TOWA ファイン株式会社(韓国)

株式情報

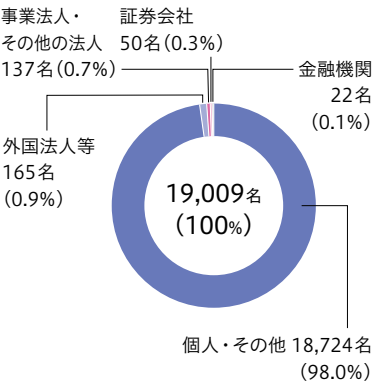
発行可能株式総数	80,000,000株
発行済株式の総数	25,021,832株
株主数	19,099名
事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日までの1年
定時株主総会	毎年6月
基準日	株主総会権利行使および期末配当 3月31日 中間配当 9月30日
単元株式数	100株
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部
郵便物の郵送先及び 電話お問い合わせ先	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社証券代行部 ☎0120-288-324(フリーダイヤル)
未払い配当金のお支払	みずほ信託銀行 本店および全国各支店 みずほ銀行 本店および全国各支店
公告方法	電子公告の方法により行います。但し、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載 URL https://www.towajapan.co.jp

大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	2,816	11.26
株式会社日本カストディ銀行	2,606	10.42
株式会社ケイビー恒産	2,000	8.00
蒲生徳子	1,028	4.11
株式会社京都銀行	699	2.80
株式会社エヌレガロ	600	2.40
TOWA 社員持株会	367	1.47
京都中央信用金庫	300	1.20
JP MORGAN CHASE BANK 385781	299	1.20
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)	263	1.05

(注1) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社および株式会社日本カストディ銀行の持株数は信託業務に係るものです。
(注2) 持ち株比率は、自己株式(13,221株)を控除して計算しております。

所有者別株主数分布



所有者別株式数分布

